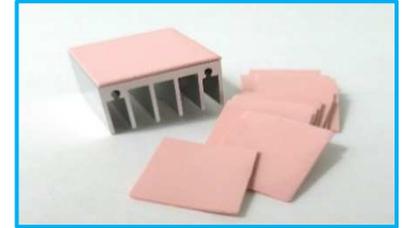


Nos Mousse Thermique appelés aussi Gap Pad ou Gap Filler sont des matériaux thermo conducteurs à base de silicone qui permettent de résoudre les problèmes de dissipation thermique. Le TGF_012_BXS est un matelas fibre de verre spécialement développé pour des applications où un besoin de refroidissement faible est demandé. En effet, celui-ci est un bon conducteur thermique de 1.2W/mK, avec une bonne résistance thermique facilitant ainsi le transfert de la chaleur et qui a également une excellente isolation électrique. Nous pouvons découper selon plan client. Tous nos matelas sont certifiés UL 94 en V0.

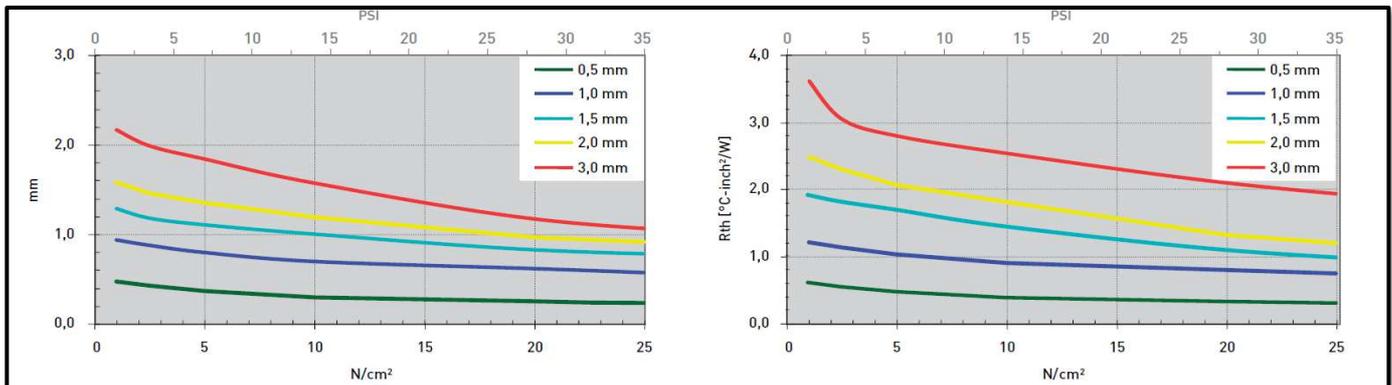


Domaines d'applications: Electronic components - Electric Vehicles, 5G, Autopilot System, Mobile Phone, AIOT, HPC (High Performance Computing), Server, IC, CPU, MOS, LED ,Mother Board, Power Supply, Heat Sink, LCD-TV, Notebook, PC, Telecom Device, Wireless Hub, DDR II Module, etc.

Caractéristiques techniques

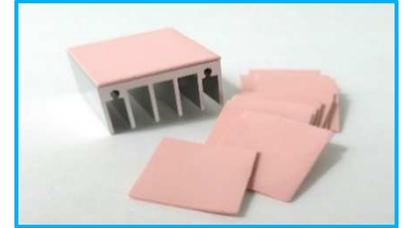
Caractéristiques	Unit	TGF_012_BXS			
		0.5	1	2	3
Epaisseur	mm	0.5	1	2	3
Renforcement	-	-			
Couleur	-	Rose			
Dureté	Shore 00	30			
Taille	mm	200*400			
Résistance @35 Psi	°C-inch ² /W (mm)	0.31 (0.24)	0.75 (0.58)	1.20 (0.92)	1.95 (1.09)
Résistance @15 Psi		0.39 (0.30)	0.90 (0.70)	1.81 (1.19)	2.54 (1.57)
Résistance @7 Psi		0.48 (0.37)	1.03 (0.80)	2.07 (1.35)	2.80 (1.84)
Conductivité thermique	W/mK	1.2			
Température	°C	-40 to 150			
Tension de claquage	kV/mm	> 6.5			
Résistance volumique	Ohm - cm	3.5 x 10 ¹²			
Contante dielectric	@1MHz	3.87			

Le TGF_012_BXS est disponible en 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/...12mm d'épaisseurs.



Les résultats ont été obtenus en conditions de laboratoire et doivent être considérés uniquement à titre indicatif. AB2E n'ayant aucun contrôle sur le matériel de ses clients et sur de nombreux autres facteurs, il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer ses propres tests pour s'assurer que le produit correspond bien à ses besoins.

Nos Mousse Thermique appelés aussi Gap Pad ou Gap Filler sont des matériaux thermo conducteurs à base de silicone qui permettent de résoudre les problématiques de dissipation thermique. Le TGF_013_DXS_(GF) est un matelas fibre de verre spécialement développé pour des applications où un besoin de refroidissement faible est demandé. En effet, celui-ci est un bon conducteur thermique de 1.3W/mK, avec une bonne résistance thermique facilitant ainsi le transfert de la chaleur et qui a également une excellente isolation électrique. Nous pouvons découper selon plan client. Tous nos matelas sont certifiés UL 94 en V0.

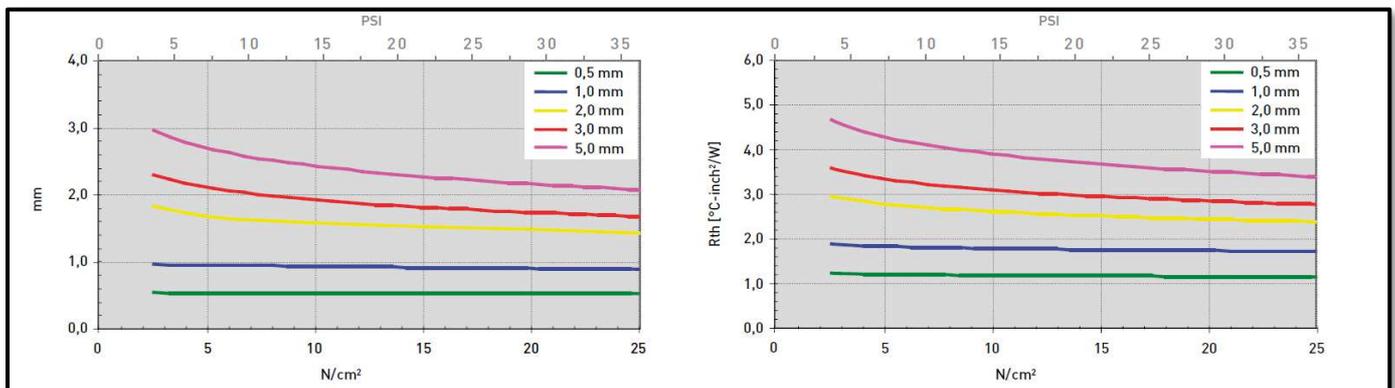


Domaines d'applications: Electronic components - Electric Vehicles, 5G, Autopilot System, Mobile Phone, AIOT, HPC (High Performance Computing), Server, IC, CPU, MOS, LED ,Mother Board, Power Supply, Heat Sink, LCD-TV, Notebook, PC, Telecom Device, Wireless Hub, DDR II Module, etc.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Unit	TGF_013_DXS			
		1	2	3	5
Epaisseur	mm	1	2	3	5
Renforcement	-	Renforcé fibre de verre			
Couleur	-	Blanc/Rose			
Dureté	Shore 00	25			
Taille	mm	200*400			
Résistance @35 Psi	°C-inch ² /W (mm)	1.77 (0.94)	2.43 (1.40)	2.80 (1.65)	3.40 (2.10)
Résistance @15 Psi		1.85 (0.95)	2.70 (1.60)	3.10 (1.95)	3.95 (2.55)
Résistance @7 Psi		1.86 (0.97)	2.80 (1.70)	3.30 (2.20)	4.40 (2.70)
Conductivité thermique	W/mK	1.3			
Température	°C	-40 to 180			
Tension de claquage	kV/mm	6			
Résistance volumique	Ohm - cm	6.2 x 10 ¹⁵			
Contante dielectric	@1MHz	5.27			

Le TGF_013_DXS_GF est disponible en 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10mm d'épaisseurs.



Les résultats ont été obtenus en conditions de laboratoire et doivent être considérés uniquement à titre indicatif. AB2E n'ayant aucun contrôle sur le matériel de ses clients et sur de nombreux autres facteurs, il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer ses propres tests pour s'assurer que le produit correspond bien à ses besoins.

Nos Mousse Thermique appelés aussi Gap Pad ou Gap Filler sont des matériaux thermo conducteurs à base de silicone qui permettent de résoudre les problèmes de dissipation thermique. Le TGF_020_JUS est un matelas spécialement développé pour des applications où un besoin de refroidissement faible est demandé. En effet, celui-ci est un BON conducteur thermique de 2W/mK, avec une bonne résistance thermique facilitant ainsi le transfert de la chaleur et qui a également une excellente isolation électrique. Nous pouvons découper selon plan client. Tous nos matelas sont certifiés UL 94 en V0.

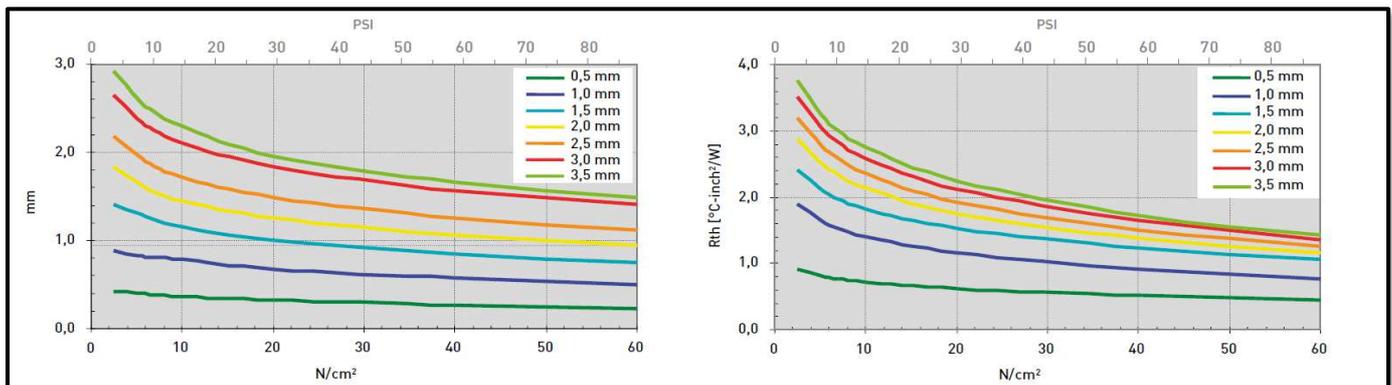


Domaines d'applications: Electronic components - Electric Vehicles, 5G, Autopilot System, Mobile Phone, AIOT, HPC (High Performance Computing), Server, IC, CPU, MOS, LED ,Mother Board, Power Supply, Heat Sink, LCD-TV, Notebook, PC, Telecom Device, Wireless Hub, DDR II Module, etc.

Caractéristiques techniques

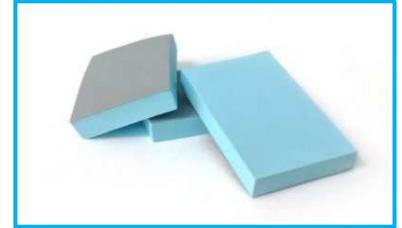
Caractéristiques	Unit	TGF_020_JUS			
		0.5	1	2	3
Epaisseur	mm	0.5	1	2	3
Renforcement	-	-			
Couleur	-	Gris			
Dureté	Shore 00	40			
Taille	mm	480*460	480*460	460*460	450*460
Résistance @60 Psi	°C-inch ² /W (mm)	0.60 (0.35)	1.00 (0.65)	1.40 (1.10)	1.70 (1.60)
Résistance @30 Psi		0.70 (0.40)	1.20 (0.75)	1.80 (1.30)	2.10 (1.85)
Résistance @10 Psi		0.80 (0.45)	1.50 (0.85)	2.30 (1.58)	2.80 (2.25)
Conductivité thermique	W/mK	2			
Température	°C	-60 to 180			
Tension de claquage	kV/mm	10			
Résistance volumique	Ohm - cm	1.0 x 10 ¹¹			
Contante dielectric	@1MHz	5			

Le TGF_020_JUS est disponible en 0.5/1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5mm d'épaisseurs.



Les résultats ont été obtenus en conditions de laboratoire et doivent être considérés uniquement à titre indicatif. AB2E n'ayant aucun contrôle sur le matériel de ses clients et sur de nombreux autres facteurs, il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer ses propres tests pour s'assurer que le produit correspond bien à ses besoins.

Nos Mousse Thermique appelés aussi Gap Pad ou Gap Filler sont des matériaux thermo conducteurs à base de silicone qui permettent de résoudre les problèmes de dissipation thermique. LeTGF_030_MUS est un matelas spécialement développé pour des applications où un besoin de refroidissement faible est demandé. En effet, celui-ci est un BON conducteur thermique de 3.0W/mK, avec une bonne résistance thermique facilitant ainsi le transfert de la chaleur et qui a également une excellente isolation électrique. Nous pouvons découper selon plan client. Tous nos matelas sont certifiés UL 94 en V0.

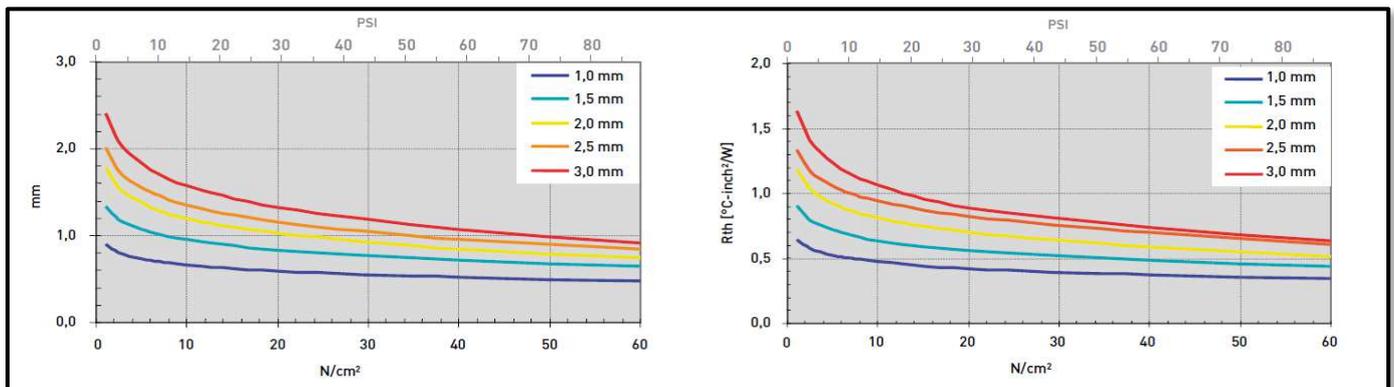


Domaines d'applications: Electronic components - Electric Vehicles, 5G, Autopilot System, Mobile Phone, AIOT, HPC (High Performance Computing), Server, IC, CPU, MOS, LED ,Mother Board, Power Supply, Heat Sink, LCD-TV, Notebook, PC, Telecom Device, Wireless Hub, DDR II Module, etc.

Caractéristiques techniques

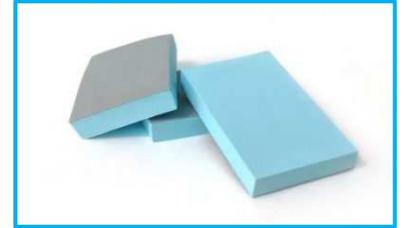
Caractéristiques	Unit	TGF_030_MUS			
		1	2	3	-
Epaisseur	mm	1	2	3	-
Renforcement	-	-			
Couleur	-	Bleu clair			
Dureté	Shore 00	20			
Taille	mm	480*460	460*460	450*460	-
Résistance @60 Psi	°C-inch ² /W (mm)	0.37 (0.52)	0.58 (0.85)	0.74 (1.06)	-
Résistance @30 Psi		0.42 (0.59)	0.70 (1.02)	0.89 (1.32)	-
Résistance @10Psi		0.49 (0.70)	0.89 (1.29)	1.20 (1.70)	-
Conductivité thermique	W/mK	3.0			
Température	°C	-60 to 180			
Tension de claquage	kV/mm	10			
Résistance volumique	Ohm - cm	1.0 x 10 ¹¹			
Contante dielectric	@1MHz	5.2			

Le TGF_030_MUS est disponible en 1/1.5/2/2.5/3/4/5mm d'épaisseurs.



Les résultats ont été obtenus en conditions de laboratoire et doivent être considérés uniquement à titre indicatif. AB2E n'ayant aucun contrôle sur le matériel de ses clients et sur de nombreux autres facteurs, il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer ses propres tests pour s'assurer que le produit correspond bien à ses besoins.

Nos Mousse Thermique appelés aussi Gap Pad ou Gap Filler sont des matériaux thermo conducteurs à base de silicone qui permettent de résoudre les problèmes de dissipation thermique. Le TGF_030_RSS est un matelas spécialement développé pour des applications où un besoin de refroidissement faible est demandé. En effet, celui-ci est un BON conducteur thermique de 3.0W/mK, avec une bonne résistance thermique facilitant ainsi le transfert de la chaleur et qui a également une excellente isolation électrique. Nous pouvons découper selon plan client. Tous nos matelas sont certifiés UL 94 en V0.

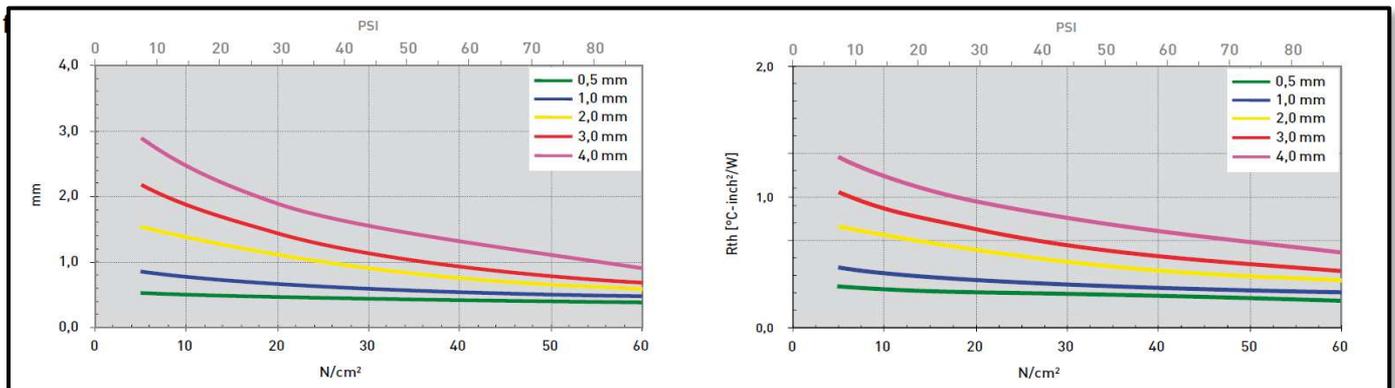


Domaines d'applications: Electronic components - Electric Vehicles, 5G, Autopilot System, Mobile Phone, AIOT, HPC (High Performance Computing), Server, IC, CPU, MOS, LED ,Mother Board, Power Supply, Heat Sink, LCD-TV, Notebook, PC, Telecom Device, Wireless Hub, DDR II Module, etc.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Unit	TGF_030_RSS			
		0.5	1	2	3
Epaisseur	mm	0.5	1	2	3
Renforcement	-	-			
Couleur	-	Bleu clair			
Dureté	Shore 00	43			
Taille	mm	200*400			
Résistance @60 Psi	°C-inch ² /W (mm)	0.25 (0.41)	0.31 (0.52)	0.44 (0.73)	0.54 (0.93)
Résistance @30 Psi		0.27 (0.44)	0.37 (0.67)	0.59 (1.10)	0.75 (1.44)
Résistance @10Psi		0.30 (0.48)	0.45 (0.81)	0.75 (1.48)	0.99 (2.08)
Conductivité thermique	W/mK	3			
Température	°C	-50 to 170			
Tension de claquage	kV/mm	> 7			
Résistance volumique	Ohm - cm	1.0 x 10 ¹³			
Contante dielectric	@1MHz	5.6			

Le TGF_030_RSS est disponible en 0.5/1/2/3/4/5/.../10mm d'épaisseurs.



Les résultats ont été obtenus en conditions de laboratoire et doivent être considérés uniquement à titre indicatif. AB2E n'ayant aucun contrôle sur le matériel de ses clients et sur de nombreux autres facteurs, il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer ses propres tests pour s'assurer que le produit correspond bien à ses besoins.

Nos Mousse Thermique appelés aussi Gap Pad ou Gap Filler sont des matériaux thermo conducteurs à base de silicone qui permettent de résoudre les problèmes de dissipation thermique. Le TGF_045_U est un matelas spécialement développé pour des applications où un besoin de refroidissement faible est demandé. En effet, celui-ci est un BON conducteur thermique de 4.5W/mK, avec une bonne résistance thermique facilitant ainsi le transfert de la chaleur et qui a également une excellente isolation électrique. Nous pouvons découper selon plan client. Tous nos matelas sont certifiés UL 94 en V0.

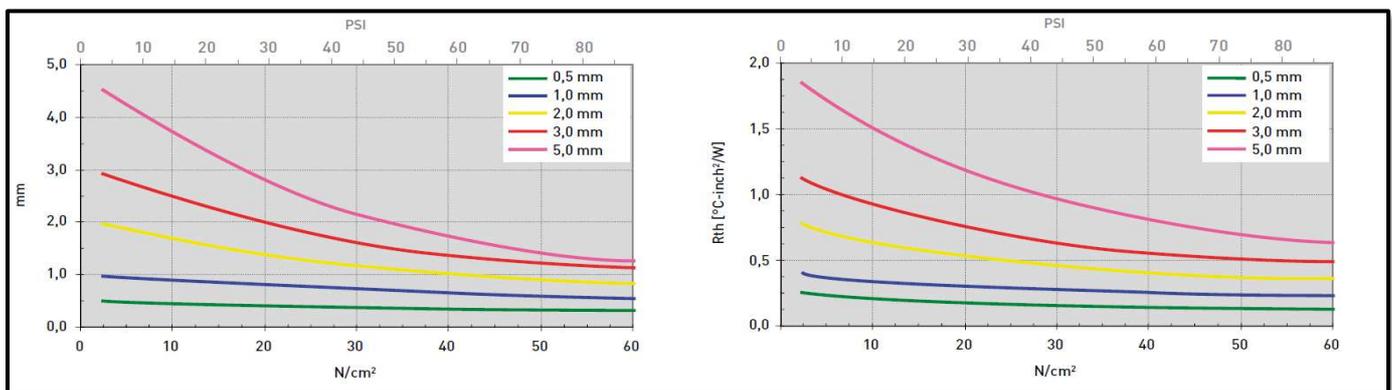


Domaines d'applications: Electronic components - Electric Vehicles, 5G, Autopilot System, Mobile Phone, AIOT, HPC (High Performance Computing), Server, IC, CPU, MOS, LED ,Mother Board, Power Supply, Heat Sink, LCD-TV, Notebook, PC, Telecom Device, Wireless Hub, DDR II Module, etc.

Caractéristiques techniques

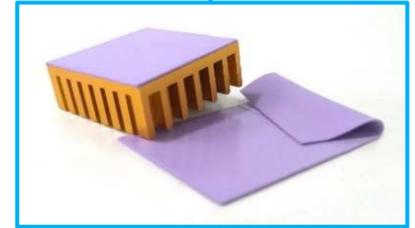
Caractéristiques	Unit	TGF_045_U			
		0.5	1	2	3
Epaisseur	mm	0.5	1	2	3
Renforcement	-	-			
Couleur	-	Gris			
Dureté	Shore 00	60			
Taille	mm	300*400			
Résistance @60 Psi	°C-inch ² /W (mm)	0.15 (0.35)	0.27 (0.65)	0.42 (1.03)	0.57 (1.40)
Résistance @30 Psi		0.17 (0.40)	0.32 (0.81)	0.55 (1.40)	0.78 (1.98)
Résistance @10Psi		0.22 (0.45)	0.36 (0.91)	0.68 (1.77)	0.99 (2.63)
Conductivité thermique	W/mK	4.5			
Température	°C	-60 to 180			
Tension de claquage	kV/mm	15			
Résistance volumique	Ohm - cm	-			
Contante dielectric	@1MHz	-			

Le TGF_045_U est disponible en 0.5/1/1.5/2/2.5/3/4/5mm d'épaisseurs.



Les résultats ont été obtenus en conditions de laboratoire et doivent être considérés uniquement à titre indicatif. AB2E n'ayant aucun contrôle sur le matériel de ses clients et sur de nombreux autres facteurs, il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer ses propres tests pour s'assurer que le produit correspond bien à ses besoins.

Nos Mousse Thermique appelés aussi Gap Pad ou Gap Filler sont des matériaux thermo conducteurs à base de silicone qui permettent de résoudre les problématiques de dissipation thermique. Le TGF_045_AB est un matelas spécialement développé pour des applications où un besoin de refroidissement moyen est demandé. En effet, celui-ci est un excellent conducteur thermique de 4.5W/mK, avec une bonne résistance thermique facilitant ainsi le transfert de la chaleur et qui a également une excellente isolation électrique. En dessous de 1mm, le matelas est difficilement utilisable en pick-in-place pour de la production robotisée, dans ce cas il faudra prévoir un ajustement de sa dureté avant utilisation. Nous pouvons découper selon plan client.

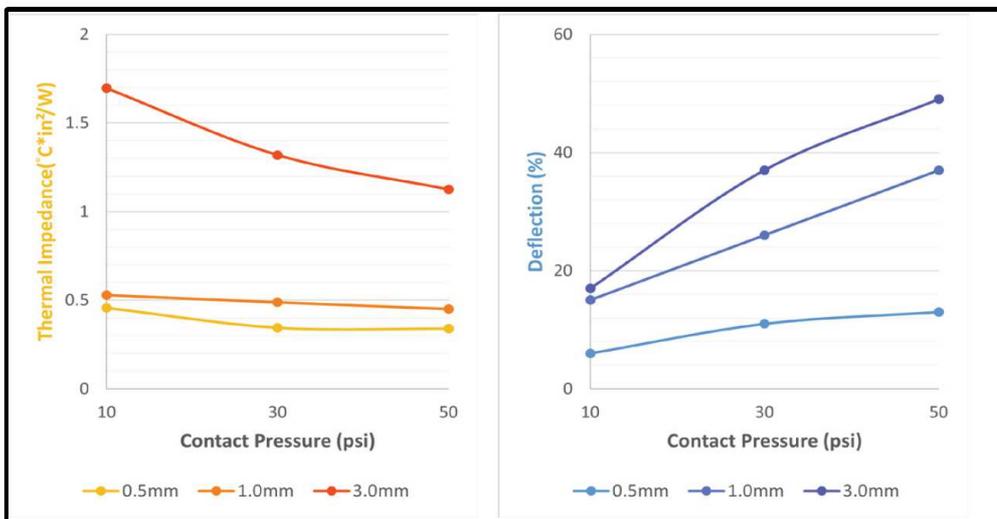


Domaines d'applications: Electronic components - Electric Vehicles, 5G, Autopilot System, Mobile Phone, AIOT, HPC (High Performance Computing), Server, IC, CPU, MOS, LED ,Mother Board, Power Supply, Heat Sink, LCD-TV, Notebook, PC, Telecom Device, Wireless Hub, DDR II Module, etc.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	TGF_045_AB	Unit	Tolerance	Test Method
Couleur	Violet	-	-	Colorimeter CIE 1976
Densité	3.1	g/cm ³	+/- 5%	ASTM D792
Epaisseur	0.5-11	mm	-	ASTM D374
Dureté	50	shore 00	+/- 15%	ASTM D2240
Taille	310*310	mm	-	-
Conductivité Thermique	4.5	W/mK	+/- 10%	ASTM D5470 Modifiée
Perte de poids	< 1	%	-	ASTM E595
Elongation	50	%	-	ASTM D412
Tension de claquage	≥ 10	kV/mm	-	ASTM D149
Résistance volumique	1×10 ¹³	Ohm-m	-	ASTM D257
Certificat UL	V-0	-	-	UL 94
Température	-50 to 180	°C	-	-

Le TGF_045_AB est disponible de 0.5 à 11mm mm d'épaisseurs.



Les résultats ont été obtenus en conditions de laboratoire et doivent être considérés uniquement à titre indicatif. AB2E n'ayant aucun contrôle sur le matériel de ses clients et sur de nombreux autres facteurs, il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer ses propres tests pour s'assurer que le produit correspond bien à ses besoins.



Nos Mousse Thermique appelés aussi Gap Pad ou Gap Filler sont des matériaux thermo conducteurs à base de silicone qui permettent de résoudre les problématiques de dissipation thermique. Le TGF_050_AB est un matelas spécialement développé pour des applications où un besoin de refroidissement moyen est demandé. En effet, celui-ci est un excellent conducteur thermique de 5W/mK, avec une bonne résistance thermique facilitant ainsi le transfert de la chaleur et qui a également une excellente isolation électrique. En dessous de 1mm, le matelas est difficilement utilisable en pick-in-place pour de la production robotisée, dans ce cas il faudra prévoir un ajustement de sa dureté avant utilisation. Nous pouvons découper selon plan client.

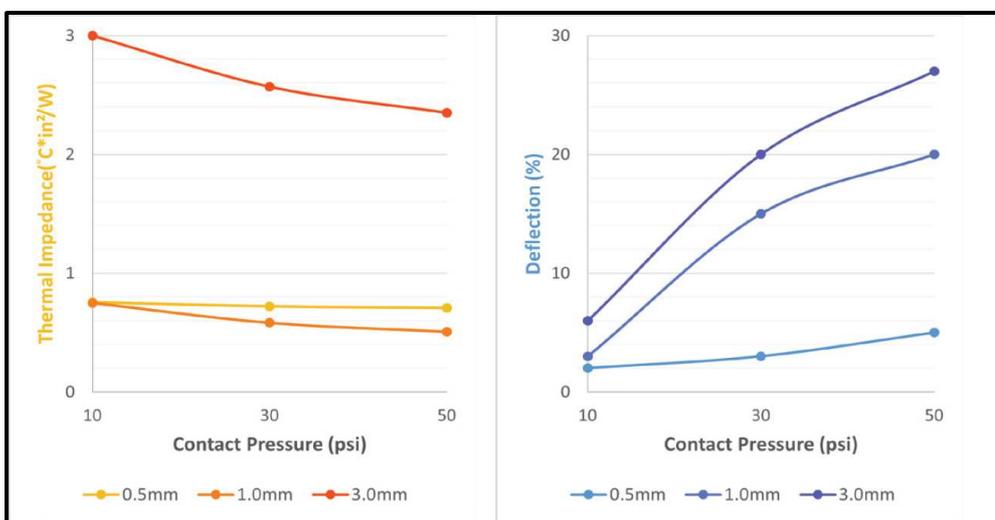


Domaines d'applications: Electronic components - Electric Vehicles, 5G, Autopilot System, Mobile Phone, AIOT, HPC (High Performance Computing), Server, IC, CPU, MOS, LED ,Mother Board, Power Supply, Heat Sink, LCD-TV, Notebook, PC, Telecom Device, Wireless Hub, DDR II Module, etc.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	TGF_050_AB	Unit	Tolerance	Test Method
Couleur	Bleu	-	-	Colorimeter CIE 1976
Densité	3.1	g/cm ³	+/- 5%	ASTM D792
Renforcement	Fibre de verre	-	-	-
Dureté	50	shore 00	+/- 15%	ASTM D2240
Taille	310*310	mm	-	-
Conductivité Thermique	5	W/mK	+/- 10%	ASTM D5470 Modifiée
Perte de poids	< 1	%	-	ASTM E595
Elongation	50	%	-	ASTM D412
Tension de claquage	≥ 12	kV/mm	-	ASTM D149
Résistance volumique	1×10 ¹³	Ohm-m	-	ASTM D257
Certificat UL	V-0	-	-	UL 94
Température	-50 to 180	°C	-	-

Le TGF-050_AB est disponible de 0.5 à 11mm mm d'épaisseurs.



Les résultats ont été obtenus en conditions de laboratoire et doivent être considérés uniquement à titre indicatif. AB2E n'ayant aucun contrôle sur le matériel de ses clients et sur de nombreux autres facteurs, il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer ses propres tests pour s'assurer que le produit correspond bien à ses besoins.



Nos Mousse Thermique appelés aussi Gap Pad ou Gap Filler sont des matériaux thermo conducteurs à base de silicone qui permettent de résoudre les problèmes de dissipation thermique. Le TGF_055_WSS est un matelas spécialement développé pour des applications où un besoin de refroidissement faible est demandé. En effet, celui-ci est un BON conducteur thermique de 5.5W/mK, avec une bonne résistance thermique facilitant ainsi le transfert de la chaleur et qui a également une excellente isolation électrique. Nous pouvons découper selon plan client. Tous nos matelas sont certifiés UL 94 en V0.

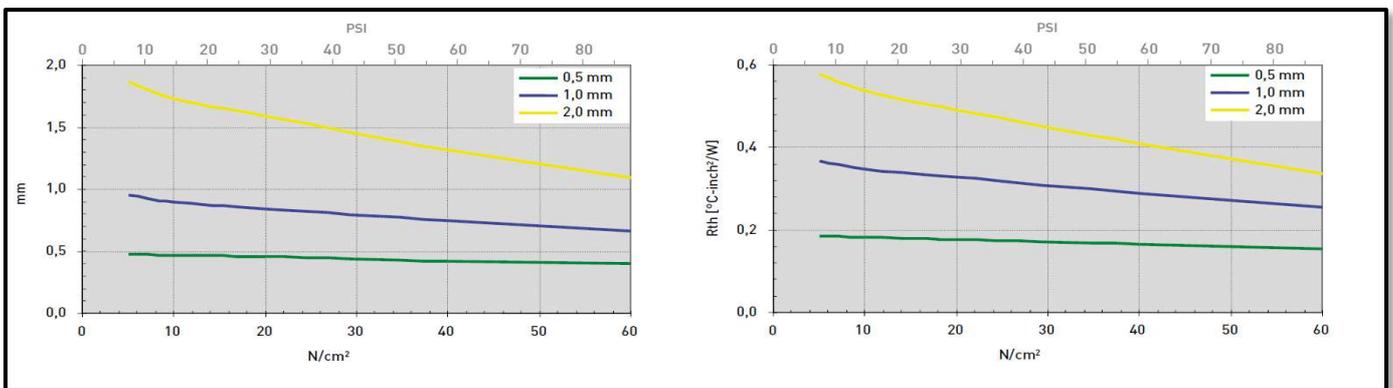


Domaines d'applications: Electronic components - Electric Vehicles, 5G, Autopilot System, Mobile Phone, AIOT, HPC (High Performance Computing), Server, IC, CPU, MOS, LED ,Mother Board, Power Supply, Heat Sink, LCD-TV, Notebook, PC, Telecom Device, Wireless Hub, DDR II Module, etc.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Unit	TGF_055_WSS			
Epaisseur	mm	1	2	-	-
Renforcement	-	-			
Couleur	-	Gris			
Dureté	Shore 00	55			
Taille	mm	460*100			
Résistance @60 Psi	°C-inch ² /W (mm)	0.30 (0.75)	0.41 (1.32)	-	-
Résistance @30 Psi		0.32 (0.85)	0.49 (1.59)	-	-
Résistance @10Psi		0.36 (0.93)	0.56 (1.80)	-	-
Conductivité thermique	W/mK	5.5			
Température	°C	-60 to 180			
Tension de claquage	kV/mm	10			
Résistance volumique	Ohm - cm	1.0x 10 ¹³			
Contante dielectric	@1MHz	-			

Le TGF_055_WSS est disponible en 0.5/1/2mm d'épaisseurs.



Les résultats ont été obtenus en conditions de laboratoire et doivent être considérés uniquement à titre indicatif. AB2E n'ayant aucun contrôle sur le matériel de ses clients et sur de nombreux autres facteurs, il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer ses propres tests pour s'assurer que le produit correspond bien à ses besoins.

Nos Mousse Thermique appelés aussi Gap Pad ou Gap Filler sont des matériaux thermo conducteurs à base de silicone qui permettent de résoudre les problématiques de dissipation thermique. Le TGF_062_AB est un matelas spécialement développé pour des applications où un besoin de refroidissement d'un niveau élevé est demandé avec une très bonne compression. En effet, celui-ci est un excellent conducteur thermique de 6.2 W/mK, avec une bonne résistance thermique facilitant ainsi le transfert de la chaleur et qui a également une excellente isolation électrique. En dessous de 1mm, le matelas étant très souple, il est difficilement utilisable en pick-in-place pour de la production robotisée, dans ce cas il faudra prévoir un ajustement de sa dureté avant utilisation.

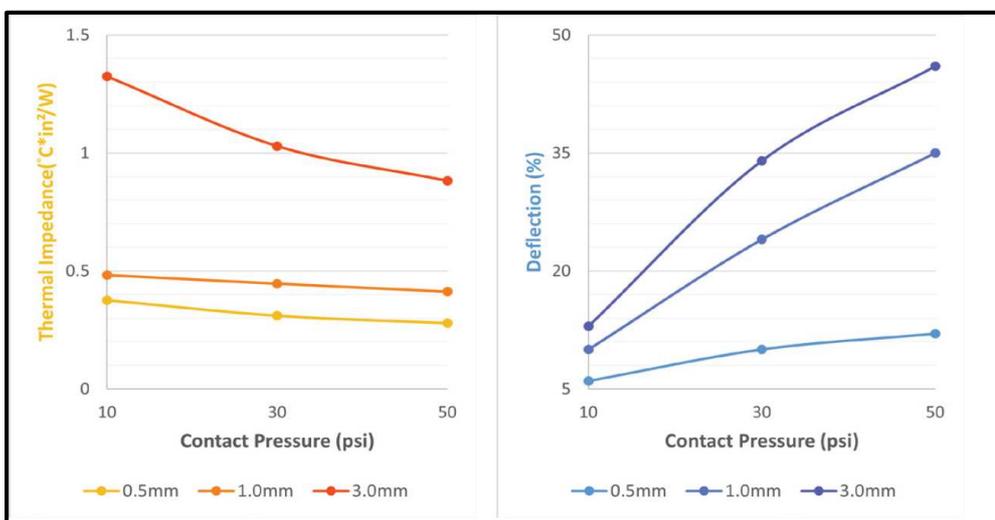


Domaines d'applications: Electronic components - Electric Vehicles, 5G, Autopilot System, Mobile Phone, AIOT, HPC (High Performance Computing), Server, IC, CPU, MOS, LED, Mother Board, Power Supply, Heat Sink, LCD-TV, Notebook, PC, Telecom Device, Wireless Hub, DDR II Module, etc.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	TGF_062_AB	Unit	Tolerance	Test Method
Couleur	Bleu	-	-	Colorimètre CIE 1976
Densité	3.1	g/cm ³	+/- 5%	ASTM D792
Epaisseur		mm	-	ASTM D374
Dureté	50	shore 00	+/- 15%	ASTM D2240
Taille	310*310	mm	-	-
Conductivité Thermique	6.2	W/mK	+/- 10%	ASTM D5470 Modifiée
Perte de poids	< 1	%	-	ASTM E595
Elongation	50	%	-	ASTM D412
Tension de claquage	≥ 10	kV/mm	-	ASTM D149
Résistance volumique	1×10 ¹³	Ohm-m	-	ASTM D257
Certificat UL	V-0	-	-	UL 94
Température	-50 to 180	°C	-	-

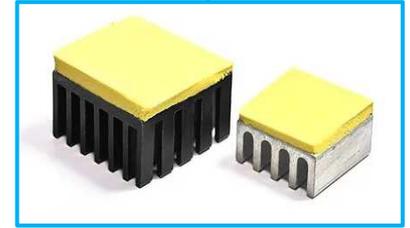
Le TGF_062_AB est disponible de 0.5 à 11mm mm d'épaisseurs.



Les résultats ont été obtenus en conditions de laboratoire et doivent être considérés uniquement à titre indicatif. AB2E n'ayant aucun contrôle sur le matériel de ses clients et sur de nombreux autres facteurs, il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer ses propres tests pour s'assurer que le produit correspond bien à ses besoins.



Nos mousses thermiques également appelées Gap Pad ou Gap Filler sont des matériaux thermo-conducteurs à base de silicone qui résolvent les problèmes de dissipation de chaleur. Le TGF-065-AB est un matelas spécialement conçu pour les applications nécessitant un refroidissement moyen. En effet, c'est un excellent conducteur thermique de 6.5W/mK, avec une bonne résistance thermique facilitant ainsi le transfert de chaleur et possède également une excellente isolation électrique. En dessous de 1mm, le matelas est difficile à utiliser en pick-in-place pour la production robotique, dans ce cas il faudra prévoir un réglage de sa dureté avant utilisation. Nous pouvons couper selon le plan du client.

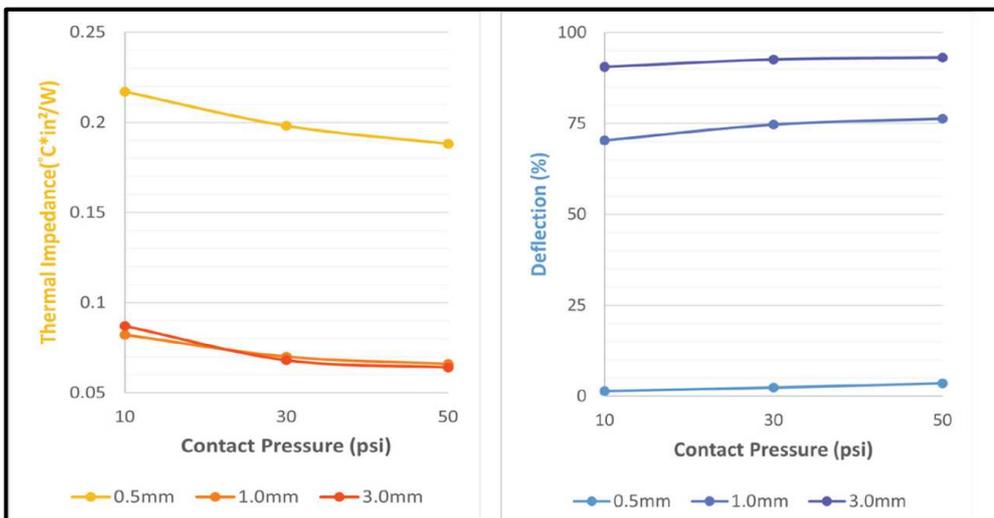


Domaines d'applications: Electronic components - Electric Vehicles, 5G, Autopilot System, Mobile Phone, AIOT, HPC (High Performance Computing), Server, IC, CPU, MOS, LED ,Mother Board, Power Supply, Heat Sink, LCD-TV, Notebook, PC, Telecom Device, Wireless Hub, DDR II Module, etc.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	TGF-065-AB	Unit	Tolerance	Test Method
Couleur	Yellow	-	-	Colorimètre CIE 1976
Densité	3.2	g/cm ³	+/- 5%	ASTM D792
Epaisseur	1-10	mm	-	ASTM D374
Dureté	25	shore 00	+/- 10%	ASTM D2240
Taille	310*310	mm	-	-
Conductivité Thermique	6.5	W/mK	+/- 10%	ASTM D5470 Modifiée
Perte de poids	< 1	%	-	ASTM E595 Modifiée
Elongation	60	%	-	ASTM D412
Tension de claquage	≥ 4	kV/mm	-	ASTM D149
Résistance volumique	10 ¹²	Ohm-m	-	ASTM D257
Certificat UL	V-0	-	-	UL 94
Température	-50 to 150	°C	-	-

Le TGF_065_AB est disponible de 1 à 10mm mm d'épaisseurs.



Les résultats ont été obtenus en conditions de laboratoire et doivent être considérés uniquement à titre indicatif. AB2E n'ayant aucun contrôle sur le matériel de ses clients et sur de nombreux autres facteurs, il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer ses propres tests pour s'assurer que le produit correspond bien à ses besoins.



Nos Mousse Thermique appelés aussi Gap Pad ou Gap Filler sont des matériaux thermo conducteurs à base de silicone qui permettent de résoudre les problématiques de dissipation thermique. Le TGF_090_AB est un matelas spécialement développé pour des applications où un besoin de refroidissement très fort est demandé. En effet, celui-ci est un excellent conducteur thermique de 9 W/mK, avec une faible résistance thermique facilitant ainsi le transfert de la chaleur et qui a également une excellente isolation électrique. Il est très souple et facilement compressible. De ce fait, en dessous de 1mm, le matelas est difficilement utilisable en pick-in-place pour de la production robotisée, dans ce cas il faudra prévoir un ajustement de sa dureté avant utilisation. Nous pouvons découper selon plan client.

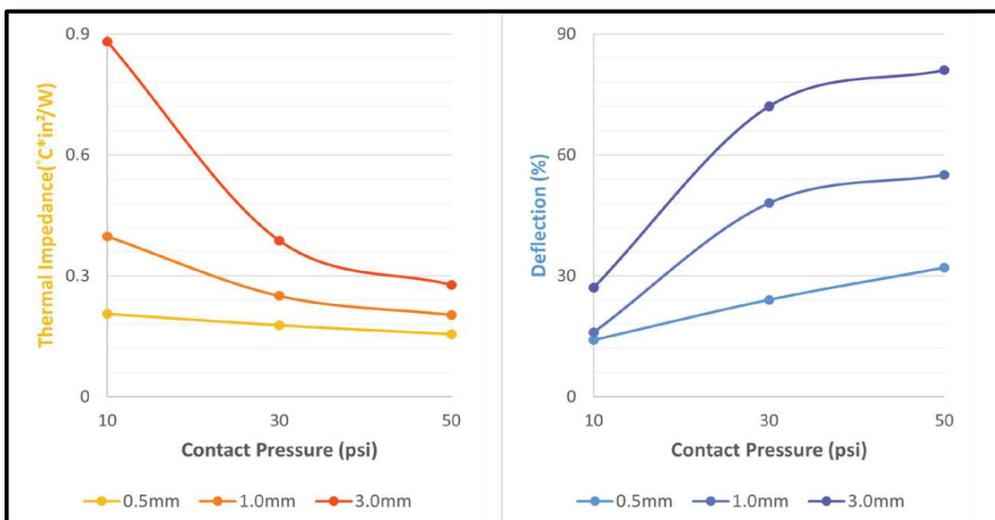


Domaines d'applications: Electronic components - Electric Vehicles, 5G, Autopilot System, Mobile Phone, AIOT, HPC (High Performance Computing), Server, IC, CPU, MOS, LED ,Mother Board, Power Supply, Heat Sink, LCD-TV, Notebook, PC, Telecom Device, Wireless Hub, DDR II Module, etc.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	TGF_090_AB	Unit	Tolerance	Test Method
Couleur	Rose	-	-	Colorimètre CIE 1976
Densité	3.2	g/cm ³	+/- 5%	ASTM D792
Epaisseur	0.5-8	mm	-	ASTM D374
Dureté	50	shore 00	+/- 15%	ASTM D2240
Taille	310*310	mm	-	-
Conductivité Thermique	9	W/mK	+/- 10%	ASTM D5470 Modifiée
Perte de poids	< 1	%	-	ASTM E595 Modifiée
Elongation	40	%	-	ASTM D412
Tension de claquage	≥ 8	kV/mm	-	ASTM D149
Résistance volumique	1 x 10 ¹²	Ohm-m	-	ASTM D257
Certificat UL	V-0	-	-	UL 94
Température	-50 to 180	°C	-	-

Le TGF_090_AB est disponible de 0.5 à 8mm mm d'épaisseurs.



Les résultats ont été obtenus en conditions de laboratoire et doivent être considérés uniquement à titre indicatif. AB2E n'ayant aucun contrôle sur le matériel de ses clients et sur de nombreux autres facteurs, il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer ses propres tests pour s'assurer que le produit correspond bien à ses besoins.



Nos Mousse Thermique appelés aussi Gap Pad ou Gap Filler sont des matériaux thermo conducteurs à base de silicone qui permettent de résoudre les problématiques de dissipation thermique. Le TGF_125_AB est un matelas spécialement développé pour des applications où un besoin de refroidissement intense est demandé. En effet, celui-ci est un excellent conducteur thermique de 12.5 W/mK, avec une très faible résistance thermique facilitant ainsi le transfert de la chaleur et qui a également une excellente isolation électrique ainsi qu'une excellente compressibilité pour un matelas haut de gamme. En dessous de 1mm, le matelas est difficilement utilisable en pick-in-place pour de la production robotisée, dans ce cas il faudra prévoir un ajustement de sa dureté aux environs de 55-75 sh avant utilisation. Nous pouvons découper selon plan client.

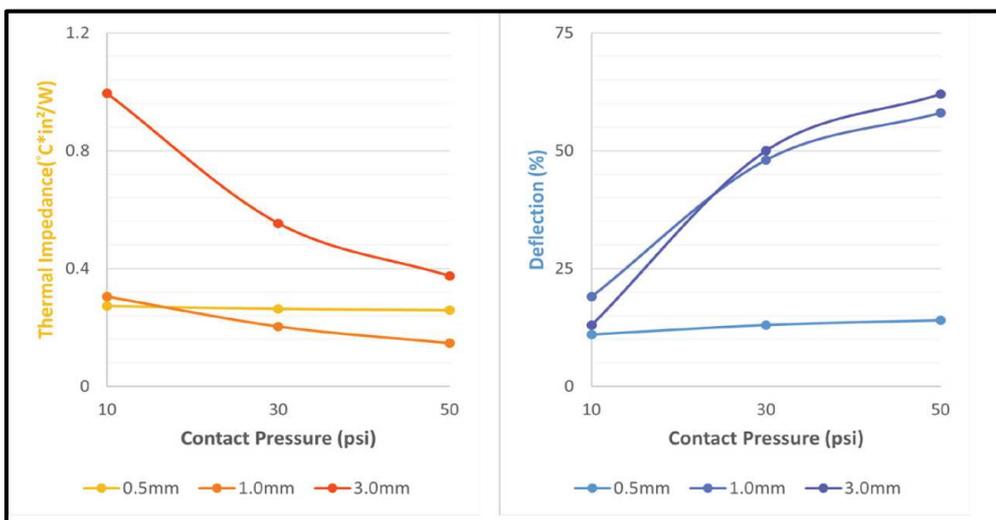


Domaines d'applications: Electronic components - Electric Vehicles, 5G, Autopilot System, Mobile Phone, AIOT, HPC (High Performance Computing), Server, IC, CPU, MOS, LED ,Mother Board, Power Supply, Heat Sink, LCD-TV, Notebook, PC, Telecom Device, Wireless Hub, DDR II Module, etc.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	TGF_125_AB	Unit	Tolerance	Test Method
Couleur	Vert	-	-	Colorimètre CIE 1976
Densité	3.3	g/cm ³	+/- 5%	ASTM D792
Epaisseur	0.5-8.0	mm	-	ASTM D374
Dureté	55	shore 00	+/- 10%	ASTM D2240
Taille	310*310	mm	-	-
Conductivité Thermique	12.5	W/mK	+/- 10%	ASTM D5470 Modifiée
Perte de poids	< 1	%	-	ASTM E595 Modifiée
Elongation	40	%	-	ASTM D412
Tension de claquage	≥ 10	kV/mm	-	ASTM D149
Résistance volumique	1×10 ¹³	Ohm-m	-	ASTM D257
Certificat UL	V-0	-	-	UL 94
Température	-50 to 180	°C	-	-

Le TGF_125_AB est disponible de 0.5 à 8mm mm d'épaisseurs.



Les résultats ont été obtenus en conditions de laboratoire et doivent être considérés uniquement à titre indicatif. AB2E n'ayant aucun contrôle sur le matériel de ses clients et sur de nombreux autres facteurs, il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer ses propres tests pour s'assurer que le produit correspond bien à ses besoins.



Nos Mousse Thermique appelés aussi Gap Pad ou Gap Filler sont des matériaux thermo conducteurs à base de silicone qui permettent de résoudre les problématiques de dissipation thermique. Le TGF_145_AB est un matelas spécialement développé pour des applications où un besoin de refroidissement intense est demandé. En effet, celui-ci est un excellent conducteur thermique de 14.5 W/mK, avec une très faible résistance thermique facilitant ainsi le transfert de la chaleur et qui a également une excellente isolation électrique. En dessous de 1mm, le matelas est difficilement utilisable en pick-in-place pour de la production robotisée, dans ce cas il faudra prévoir un ajustement de sa dureté avant utilisation. Nous pouvons découper selon plan client.

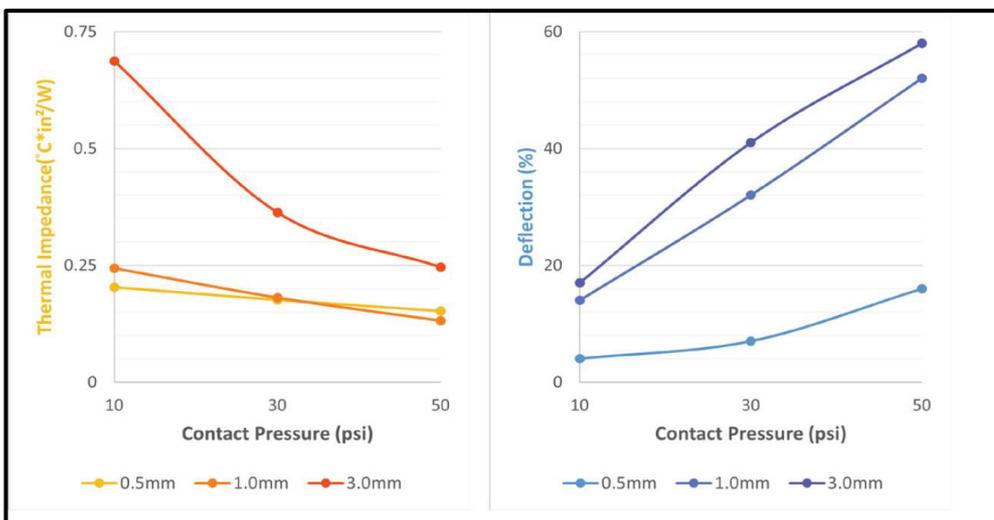


Domaines d'applications: Electronic components - Electric Vehicles, 5G, Autopilot System, Mobile Phone, AIOT, HPC (High Performance Computing), Server, IC, CPU, MOS, LED ,Mother Board, Power Supply, Heat Sink, LCD-TV, Notebook, PC, Telecom Device, Wireless Hub, DDR II Module, etc.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	TGF_145_AB	Unit	Tolerance	Test Method
Couleur	Rose	-	-	Colorimètre CIE 1976
Densité	3.6	g/cm ³	+/- 5%	ASTM D792
Epaisseur	0.5-6	mm	-	ASTM D374
Dureté	55	shore 00	+/- 10%	ASTM D2240
Taille	310*310	mm	-	-
Conductivité Thermique	14.5	W/mK	+/- 10%	ASTM D5470 Modifiée
Perte de poids	< 1	%	-	ASTM E595 Modifiée
Elongation	30	%	-	ASTM D412
Tension de claquage	≥ 8	kV/mm	-	ASTM D149
Résistance volumique	7 x 10 ¹²	Ohm-m	-	ASTM D257
Certification UL	V-0	-	-	UL 94
Température	-50 to 180	°C	-	-

Le TGF_145_AB est disponible de 0.5 à 6mm mm d'épaisseurs.



Les résultats ont été obtenus en conditions de laboratoire et doivent être considérés uniquement à titre indicatif. AB2E n'ayant aucun contrôle sur le matériel de ses clients et sur de nombreux autres facteurs, il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer ses propres tests pour s'assurer que le produit correspond bien à ses besoins.



Nos Mousse Thermique appelés aussi Gap Pad ou Gap Filler sont des matériaux thermo conducteurs à base de silicone qui permettent de résoudre les problématiques de dissipation thermique. Le TGF_166_AB est un matelas spécialement développé pour des applications où un besoin de refroidissement intense est demandé. En effet, celui-ci est un excellent conducteur thermique de 16.6 W/mK, avec une très faible résistance thermique facilitant ainsi le transfert de la chaleur et qui a également une excellente isolation électrique. En dessous de 1mm, le matelas est difficilement utilisable en pick-in-place pour de la production robotisée, dans ce cas il faudra prévoir un ajustement de sa dureté avant utilisation. Nous pouvons découper selon plan client.

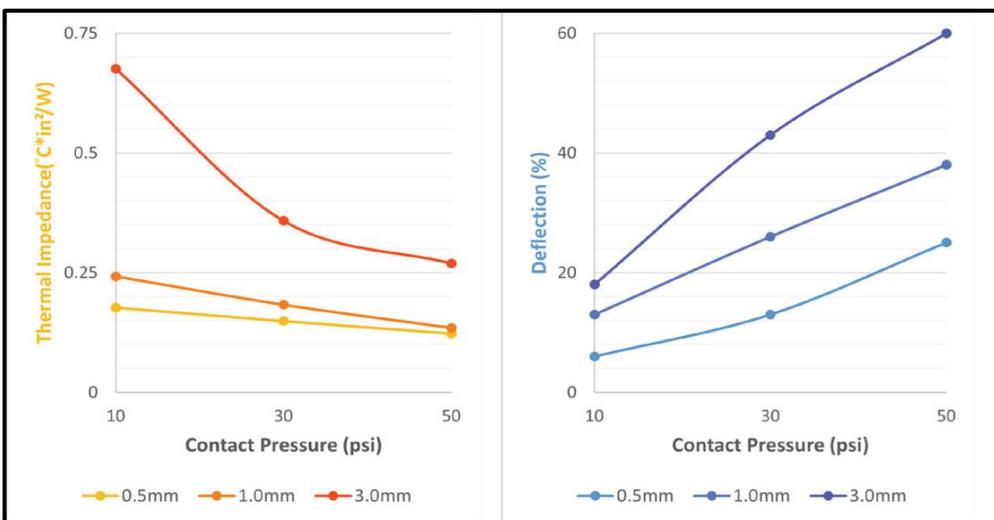


Domaines d'applications: Electronic components - Electric Vehicles, 5G, Autopilot System, Mobile Phone, AIOT, HPC (High Performance Computing), Server, IC, CPU, MOS, LED ,Mother Board, Power Supply, Heat Sink, LCD-TV, Notebook, PC, Telecom Device, Wireless Hub, DDR II Module, etc.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	TGF_166_AB	Unit	Tolerance	Test Method
Couleur	Gris foncé	-	-	Colorimètre CIE 1976
Densité	3.6	g/cm ³	+/- 5%	ASTM D792
Epaisseur	0.5-6	mm	-	ASTM D374
Dureté	65	shore 00	+/- 10%	ASTM D2240
Taille	310*310	mm	-	-
Conductivité Thermique	16.6	W/mK	+/- 10%	ASTM D5470 Modifiée
Perte de poids	< 1	%	-	ASTM E595 Modifiée
Elongation	20	%	-	ASTM D412
Tension de claquage	≥ 7	kV/mm	-	ASTM D149
Résistance volumique	5 x 10 ¹²	Ohm-m	-	ASTM D257
Certification UL	V-0	-	-	UL 94
Température	-50 to 180	°C	-	-

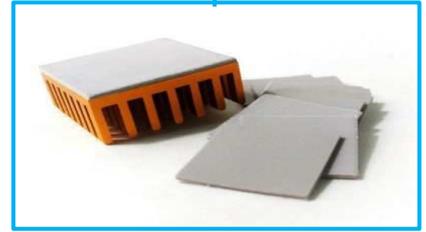
Le TGF_166_AB est disponible de 0.5 à 6mm mm d'épaisseurs.



Les résultats ont été obtenus en conditions de laboratoire et doivent être considérés uniquement à titre indicatif. AB2E n'ayant aucun contrôle sur le matériel de ses clients et sur de nombreux autres facteurs, il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer ses propres tests pour s'assurer que le produit correspond bien à ses besoins.



Nos Mousse Thermique appelés aussi Gap Pad ou Gap Filler sont des matériaux thermo conducteurs à base de silicone qui permettent de résoudre les problématiques de dissipation thermique. Le TGF_178_AB est un matelas spécialement développé pour des applications où un besoin de refroidissement moyen est demandé. En effet, celui-ci est un excellent conducteur thermique de 17.8W/mK, avec une bonne résistance thermique facilitant ainsi le transfert de la chaleur et qui a également une excellente isolation électrique. En dessous de 1mm, le matelas est difficilement utilisable en pick-in-place pour de la production robotisée, dans ce cas il faudra prévoir un ajustement de sa dureté avant utilisation. Nous pouvons découper selon plan client.

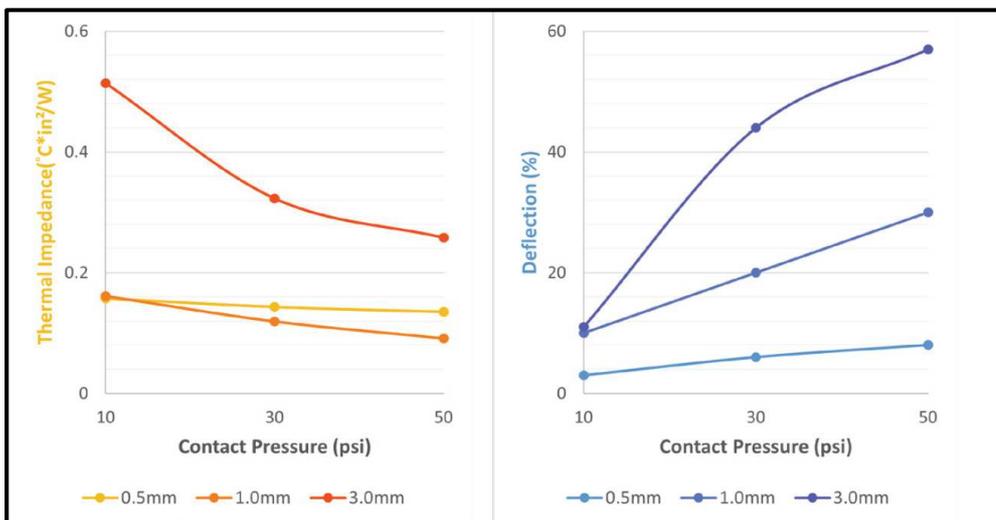


Domaines d'applications: Electronic components - Electric Vehicles, 5G, Autopilot System, Mobile Phone, AIOT, HPC (High Performance Computing), Server, IC, CPU, MOS, LED ,Mother Board, Power Supply, Heat Sink, LCD-TV, Notebook, PC, Telecom Device, Wireless Hub, DDR II Module, etc.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	TGF_178_AB	Unit	Tolerance	Test Method
Couleur	Gris clair	-	-	Colorimètre CIE 1976
Densité	3.5	g/cc	+/- 5%	ASTM D792
Epaisseur	0.5-4	mm	-	ASTM D374
Dureté	70	shore 00	+/- 10%	ASTM D2240
Taille	310*310	mm	-	-
Conductivité Thermique	17.8	W/mK	+/- 10%	ASTM D5470 Modifiée
Perte de poids	< 1	%	-	ASTM E595 Modifiée
Elongation	20	%	-	ASTM D412
Tension de claquage	≥ 8	kV/mm	-	ASTM D149
Résistance volumique	6 x 10 ¹²	Ohm-m	-	ASTM D257
Certification UL	V-0	-	-	UL 94
Température	-50 to 180	°C	-	-

Le TGF_178_AB est disponible de 0.5 à 4mm mm d'épaisseurs.



Les résultats ont été obtenus en conditions de laboratoire et doivent être considérés uniquement à titre indicatif. AB2E n'ayant aucun contrôle sur le matériel de ses clients et sur de nombreux autres facteurs, il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer ses propres tests pour s'assurer que le produit correspond bien à ses besoins.



Nos Mousses Thermique appelés aussi Gap Pad ou Gap Filler sont des matériaux thermo conducteurs **sans silicone** qui permettent de résoudre les problématiques de dissipation thermique. Le TGF_021_NS est un matelas spécialement développé pour des applications où un besoin de refroidissement moyen est demandé. En effet, celui-ci est un bon conducteur thermique de 2.1W/mK, avec une bonne résistance thermique facilitant ainsi le transfert de la chaleur et qui a également une excellente isolation électrique. En dessous de 1mm, le matelas est difficilement utilisable en pick-in-place pour de la production robotisée, dans ce cas il faudra prévoir un ajustement de sa dureté avant utilisation. Nous pouvons découper selon plan client.

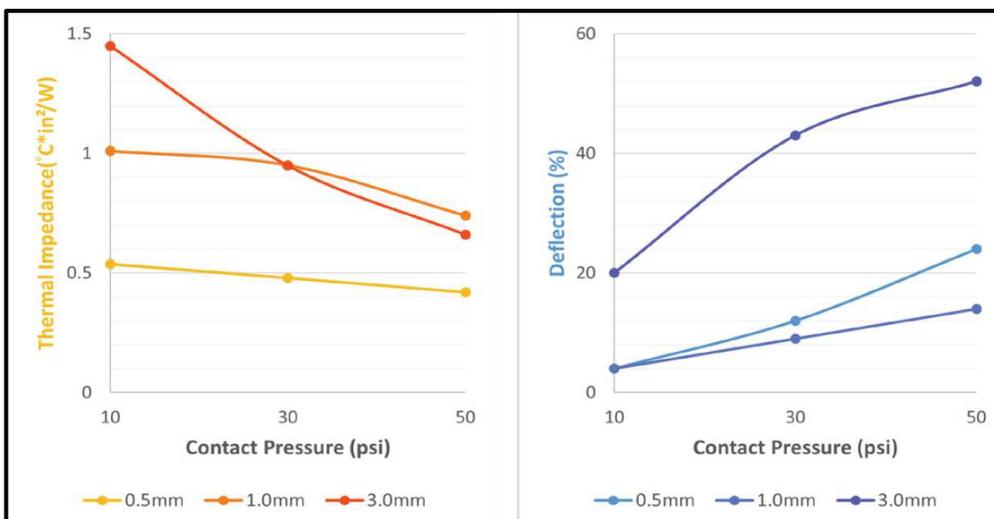


Domaines d'applications: Electronic components - Electric Vehicles, 5G, Autopilot System, Mobile Phone, AIOT, HPC (High Performance Computing), Server, IC, CPU, MOS, LED ,Mother Board, Power Supply, Heat Sink, LCD-TV, Notebook, PC, Telecom Device, Wireless Hub, DDR II Module, etc.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	TGF_021_NS	Unit	Tolerance	Test Method
Couleur	Gris	-	-	Colorimètre CIE 1976
Densité	2.1	g/cc	+/- 0.2	ASTM D792
Epaisseur	0.5-5	mm	-	ASTM D374
Dureté	70	shore 00	+/- 10	ASTM D2240
Taille	310*310	mm	-	-
Conductivité Thermique	2.1	W/mK	+/- 10%	ASTM D5470 Modifiée
Perte de poids	< 1	%	-	ASTM E595 Modifiée
Elongation	350	%	-	ASTM D412
Tension de claquage	≥ 10.2	kV/mm	-	ASTM D149
Résistance volumique	10 ¹⁰	Ohm-m	-	ASTM D257
Certification UL	V-0	-	-	UL 94
Température	-30 to 125	°C	-	-

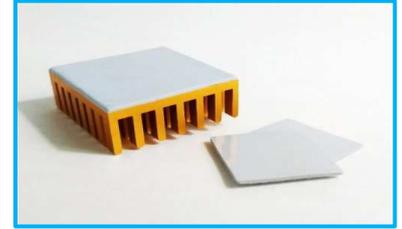
Le TGF_021_NS est disponible de 0.5 à 5mm d'épaisseurs.



Les résultats ont été obtenus en conditions de laboratoire et doivent être considérés uniquement à titre indicatif. AB2E n'ayant aucun contrôle sur le matériel de ses clients et sur de nombreux autres facteurs, il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer ses propres tests pour s'assurer que le produit correspond bien à ses besoins.



Nos Mousse Thermique appelés aussi Gap Pad ou Gap Filler sont des matériaux thermo conducteurs **non siliconné** qui permettent de résoudre les problématiques de dissipation thermique. Le TGF_030_R_NS est un matelas spécialement développé pour des applications où un besoin de refroidissement faible est demandé. En effet, celui-ci est un BON conducteur thermique de 3W/mK, avec une bonne résistance thermique facilitant ainsi le transfert de la chaleur et qui a également une excellente isolation électrique. Nous pouvons découper selon plan client. Tous nos matelas sont certifiés UL 94 en V0.

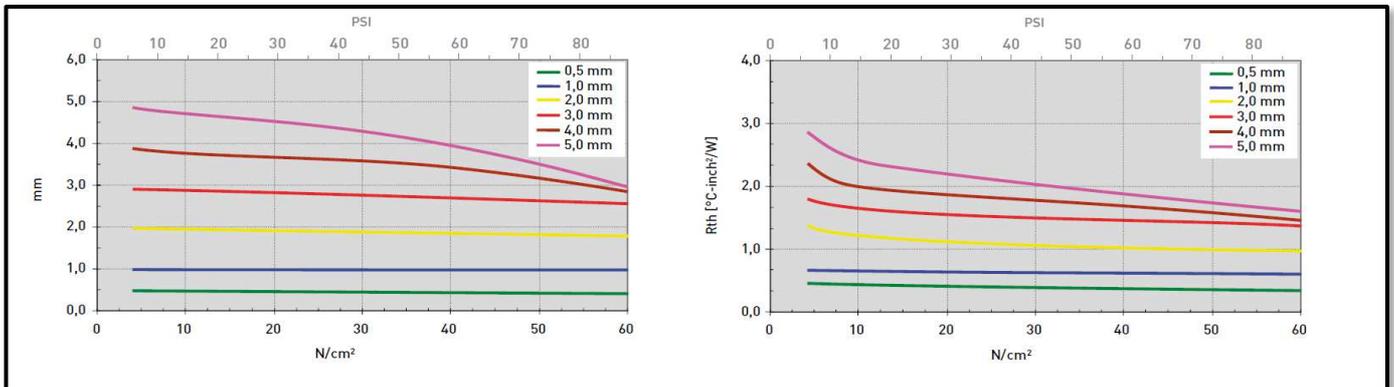


Domaines d'applications: Electronic components - Electric Vehicles, 5G, Autopilot System, Mobile Phone, AIOT, HPC (High Performance Computing), Server, IC, CPU, MOS, LED ,Mother Board, Power Supply, Heat Sink, LCD-TV, Notebook, PC, Telecom Device, Wireless Hub, DDR II Module, etc.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Unit	TGF_030_R_NS			
		0.5	1	2	3
Epaisseur	mm	0.5	1	2	3
Gravité Spécific	g/cm ³	2.9			
Couleur	-	Blanc			
Dureté	Shore 00	70			
Taille	mm	400*200			
Résistance @60 Psi	°C-inch ² /W (mm)	0.38 (0.44)	0.63 (0.97)	1.03 (1.85)	1.47 (2.71)
Résistance @30 Psi		0.42 (0.46)	0.64 (0.98)	1.12 (1.85)	1.57 (2.81)
Résistance @10 Psi		0.45 (0.47)	0.65 (0.99)	1.25 (1.96)	1.72 (2.88)
Conductivité thermique	W/mK	3			
Température	°C	-40 to 130			
Tension de claquage	kV/mm	7.8			
Résistance volumique	Ohm - cm	1 x 10 ¹¹			
Contante dielectric	@1MHz	-			

Le TGF_030_R_NS est disponible en 0.5/1/2/3/4/5mm d'épaisseurs.



Les résultats ont été obtenus en conditions de laboratoire et doivent être considérés uniquement à titre indicatif. AB2E n'ayant aucun contrôle sur le matériel de ses clients et sur de nombreux autres facteurs, il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer ses propres tests pour s'assurer que le produit correspond bien à ses besoins.

Nos Mousses Thermique appelés aussi Gap Pad ou Gap Filler sont des matériaux thermo conducteurs **sans silicone** qui permettent de résoudre les problématiques de dissipation thermique. Le TGF_042_NS est un matelas spécialement développé pour des applications où un besoin de refroidissement moyen est demandé. En effet, celui-ci est un bon conducteur thermique de 4.2W/mK, avec une bonne résistance thermique facilitant ainsi le transfert de la chaleur et qui a également une excellente isolation électrique. En dessous de 1mm, le matelas est difficilement utilisable en pick-in-place pour de la production robotisée, dans ce cas il faudra prévoir un ajustement de sa dureté avant utilisation. Nous pouvons découper selon plan client.

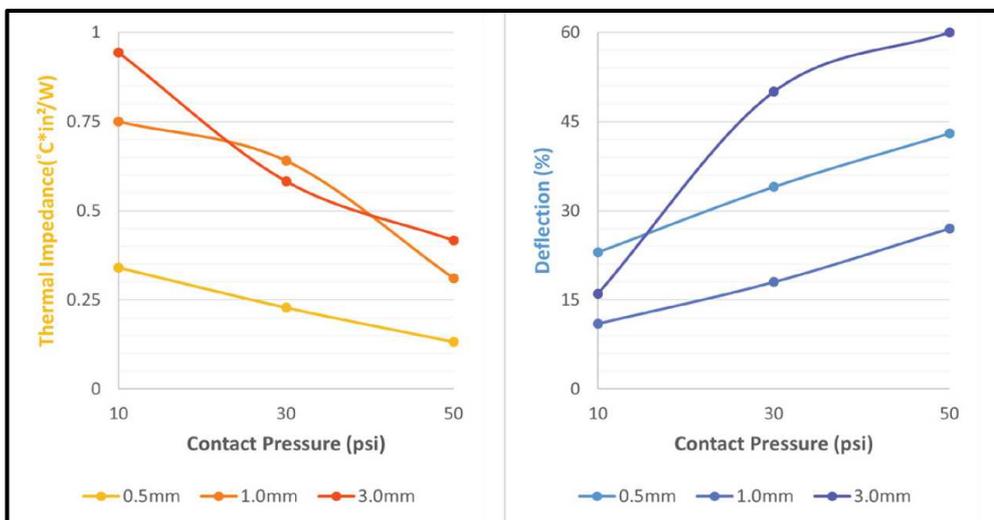


Domaines d'applications: Electronic components - Electric Vehicles, 5G, Autopilot System, Mobile Phone, AIOT, HPC (High Performance Computing), Server, IC, CPU, MOS, LED ,Mother Board, Power Supply, Heat Sink, LCD-TV, Notebook, PC, Telecom Device, Wireless Hub, DDR II Module, etc.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	TGF_042_NS	Unit	Tolerance	Test Method
Couleur	Rouge	-	-	Colorimètre CIE 1976
Densité	2.5	g/cc	+/- 0.2	ASTM D792
Epaisseur	0.5-5	mm	-	ASTM D374
Dureté	50	shore 00	+/- 10	ASTM D2240
Taille	310*310	mm	-	-
Conductivité Thermique	4.2	W/mK	+/- 10%	ASTM D5470 Modifiée
Perte de poids	< 1	%	-	ASTM E595 Modifiée
Elongation	100	%	-	ASTM D412
Tension de claquage	≥ 10.2	kV/mm	-	ASTM D149
Résistance volumique	> 10 ¹⁰	Ohm-m	-	ASTM D257
Certification UL	V-0	-	-	UL 94
Température	-30 to 125	°C	-	-

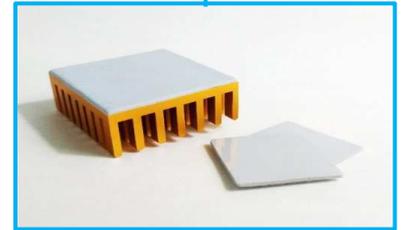
Le TGF_042_NS est disponible de 0.5 à 5mm d'épaisseurs.



Les résultats ont été obtenus en conditions de laboratoire et doivent être considérés uniquement à titre indicatif. AB2E n'ayant aucun contrôle sur le matériel de ses clients et sur de nombreux autres facteurs, il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer ses propres tests pour s'assurer que le produit correspond bien à ses besoins.



Nos Mousse Thermique appelés aussi Gap Pad ou Gap Filler sont des matériaux thermo conducteurs **non siliconné** qui permettent de résoudre les problématiques de dissipation thermique. Le TGF_060_W_NS est un matelas spécialement développé pour des applications où un besoin de refroidissement faible est demandé. En effet, celui-ci est un BON conducteur thermique de 6W/mK, avec une bonne résistance thermique facilitant ainsi le transfert de la chaleur et qui a également une excellente isolation électrique. Nous pouvons découper selon plan client. Tous nos matelas sont certifiés UL 94 en V0.

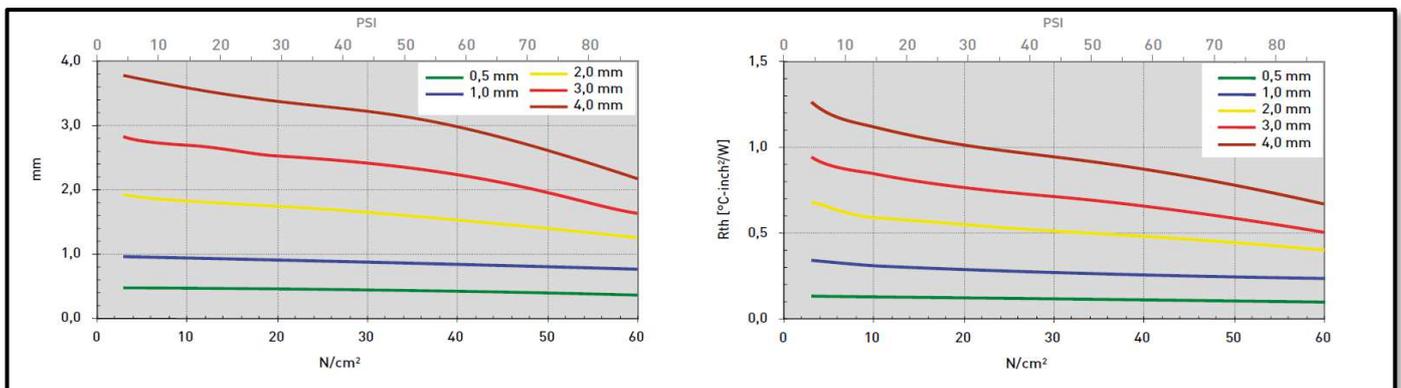


Domaines d'applications: Electronic components - Electric Vehicles, 5G, Autopilot System, Mobile Phone, AIOT, HPC (High Performance Computing), Server, IC, CPU, MOS, LED ,Mother Board, Power Supply, Heat Sink, LCD-TV, Notebook, PC, Telecom Device, Wireless Hub, DDR II Module, etc.

Caractéristiques techniques

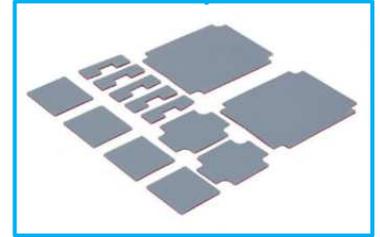
Caractéristiques	Unit	TGF_060_W_NS			
		-	1	2	3
Epaisseur	mm	-	1	2	3
Gravité Spécific	g/cm ³	3.1			
Couleur	-	Blanc			
Dureté	Shore 00	70			
Taille	mm	130*130			
Résistance @60 Psi	°C-inch ² /W (mm)	-	0.26 (0.84)	0.48 (1.54)	0.66 (2.25)
Résistance @30 Psi		-	0.28 (0.90)	0.55 (1.75)	0.76 (2.55)
Résistance @10 Psi		-	0.32 (0.95)	0.61 (1.85)	0.87 (2.75)
Conductivité thermique	W/mK	6			
Température	°C	-40 to 130			
Tension de claquage	kV/mm	7.8			
Résistance volumique	Ohm - cm	1 x 10 ¹³			
Contante dielectric	@1MHz	-			

Le TGF_060_W_NS est disponible en 0.5/1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5mm d'épaisseurs.



Les résultats ont été obtenus en conditions de laboratoire et doivent être considérés uniquement à titre indicatif. AB2E n'ayant aucun contrôle sur le matériel de ses clients et sur de nombreux autres facteurs, il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer ses propres tests pour s'assurer que le produit correspond bien à ses besoins.

Nos Mousse Thermique appelés aussi Gap Pad ou Gap Filler sont des matériaux thermo conducteurs **non siliconné** qui permettent de résoudre les problématiques de dissipation thermique. Le TGF_078_AB_NS est un matelas spécialement développé pour des applications où un besoin de refroidissement faible est demandé. En effet, celui-ci est un BON conducteur thermique de 7.8W/mK, avec une bonne résistance thermique facilitant ainsi le transfert de la chaleur et qui a également une excellente isolation électrique. Nous pouvons découper selon plan client. Tous nos matelas sont certifiés UL 94 en V0.

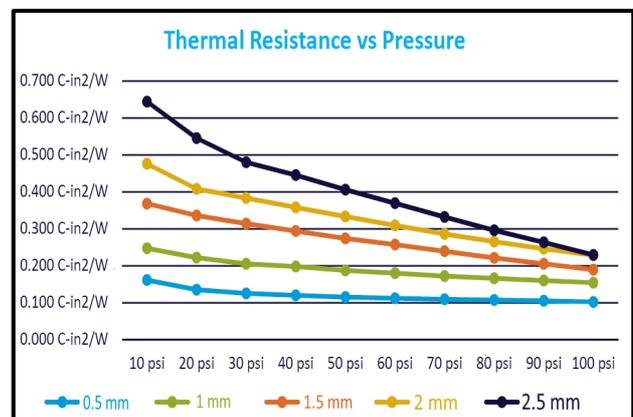
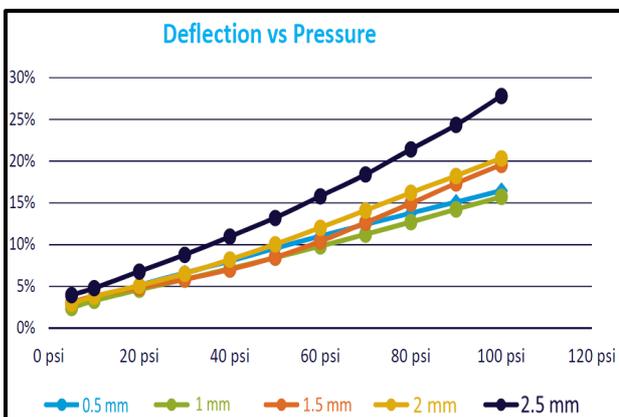


Domaines d'applications: Electronic components - Electric Vehicles, 5G, Autopilot System, Mobile Phone, AIOT, HPC (High Performance Computing), Server, IC, CPU, MOS, LED ,Mother Board, Power Supply, Heat Sink, LCD-TV, Notebook, PC, Telecom Device, Wireless Hub, DDR II Module, etc.

Caractéristiques techniques

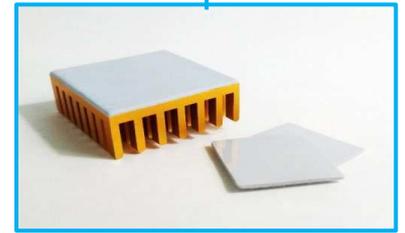
Caractéristiques	Unit	TGF_078_AB_NS			
Epaisseur	mm	0.5	1.0	2.0	-
Gravité Spécific	g/cm3	3.21			
Couleur	-	Gris			
Dureté	Shore 00	81			
Taille	mm	230*230			
Résistance @90 Psi	°C-inch ² /W	0.10	0.15	0.25	-
Résistance @60 Psi		0.11	0.18	0.31	-
Résistance @30Psi		0.12	0.20	0.38	-
Conductivité thermique	W/mK	7.8			
Température	°C	-25 to 120			
Tension de claquage	kV/mm	> 3			
Résistance volumique	Ohm - cm	10 ¹⁴			
Contante dielectric	@1MHz	16			

Le TGF_078_AB_NS est disponible en 0.5 à 5mm d'épaisseurs.



Les résultats ont été obtenus en conditions de laboratoire et doivent être considérés uniquement à titre indicatif. AB2E n'ayant aucun contrôle sur le matériel de ses clients et sur de nombreux autres facteurs, il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer ses propres tests pour s'assurer que le produit correspond bien à ses besoins.

Nos Mousse Thermique appelés aussi Gap Pad ou Gap Filler sont des matériaux thermo conducteurs **non siliconné** qui permettent de résoudre les problématiques de dissipation thermique. Le TGF_080_Y_NS est un matelas spécialement développé pour des applications où un besoin de refroidissement faible est demandé. En effet, celui-ci est un BON conducteur thermique de 8W/mK, avec une bonne résistance thermique facilitant ainsi le transfert de la chaleur et qui a également une excellente isolation électrique. Nous pouvons découper selon plan client. Tous nos matelas sont certifiés UL 94 en V0.

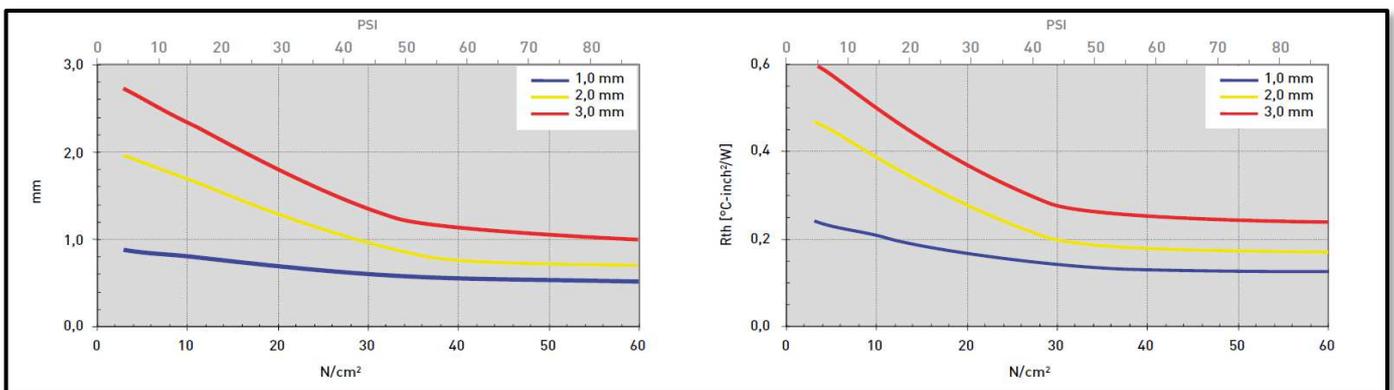


Domaines d'applications: Electronic components - Electric Vehicles, 5G, Autopilot System, Mobile Phone, AIOT, HPC (High Performance Computing), Server, IC, CPU, MOS, LED ,Mother Board, Power Supply, Heat Sink, LCD-TV, Notebook, PC, Telecom Device, Wireless Hub, DDR II Module, etc.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Unit	TGF_080_Y_NS			
		1	2	3	-
Epaisseur	mm	1	2	3	-
Gravité Spécific	g/cm ³	3.4			
Couleur	-	Blanc			
Dureté	Shore 00	70			
Taille	mm	400*200			
Résistance @60 Psi	°C-inch ² /W (mm)	0.13 (0.55)	0.18 (0.75)	0.25 (1.13)	-
Résistance @30 Psi		0.17 (0.72)	0.28 (1.30)	0.37 (1.80)	-
Résistance @10 Psi		0.22 (0.83)	0.43 (1.80)	0.55 (2.52)	-
Conductivité thermique	W/mK	8			
Température	°C	-40 to 120			
Tension de claquage	kV/mm	7.8			
Résistance volumique	Ohm - cm	1 x 10 ¹¹			
Contante dielectric	@1MHz	-			

Le TGF_080_Y_NS est disponible en 0.5/1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5mm d'épaisseurs.



Les résultats ont été obtenus en conditions de laboratoire et doivent être considérés uniquement à titre indicatif. AB2E n'ayant aucun contrôle sur le matériel de ses clients et sur de nombreux autres facteurs, il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer ses propres tests pour s'assurer que le produit correspond bien à ses besoins.

Nos Mousses Thermique appelés aussi Gap Pad ou Gap Filler sont des matériaux thermo conducteurs **non siliconné** qui permettent de résoudre les problématiques de dissipation thermique. Le TGF_100_AB_NS est un matelas spécialement développé pour des applications où un besoin de refroidissement faible est demandé. En effet, celui-ci est un BON conducteur thermique de 10W/mK, avec une bonne résistance thermique facilitant ainsi le transfert de la chaleur et qui a également une excellente isolation électrique. Nous pouvons découper selon plan client. Tous nos matelas sont certifiés UL 94 en V0.

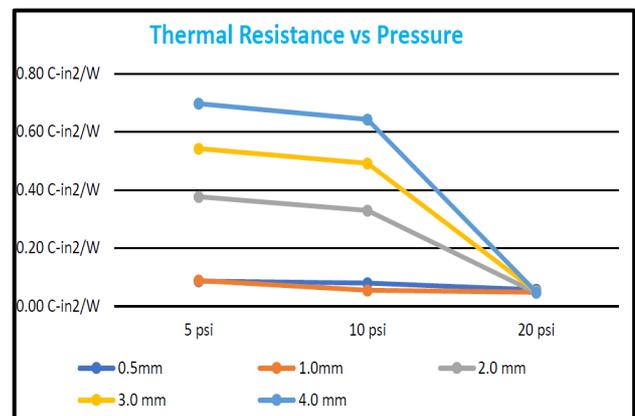
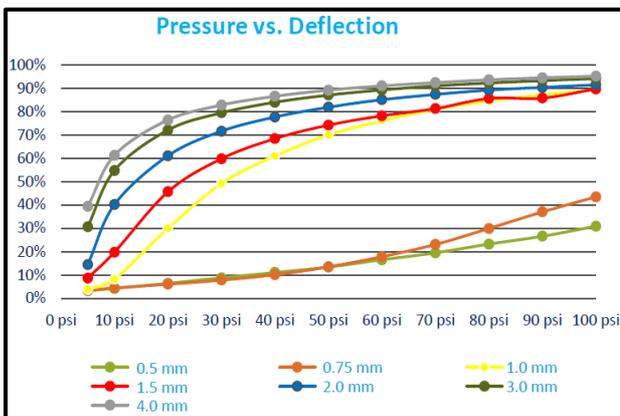


Domaines d'applications: Electronic components - Electric Vehicles, 5G, Autopilot System, Mobile Phone, AIOT, HPC (High Performance Computing), Server, IC, CPU, MOS, LED ,Mother Board, Power Supply, Heat Sink, LCD-TV, Notebook, PC, Telecom Device, Wireless Hub, DDR II Module, etc.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Unit	TGF_100_AB_NS			
Epaisseur	mm	0.5	1.0	2.0	3.0
Gravité Spécific	g/cm3	3.7			
Couleur	-	Gris			
Dureté	Shore 00	70	45		
Taille	mm	230*230			
Résistance @20 Psi	°C-inch ² /W	0.07	0.07	0.07	0.07
Résistance @10 Psi		0.08	0.07	0.36	0.49
Résistance @5 Psi		0.09	0.08	0.39	0.55
Conductivité thermique	W/mK	10			
Température	°C	-40 to 125			
Tension de claquage	kV/mm	> 3			
Résistance volumique	Ohm - cm	5 x 10 ¹²			
Contante dielectric	@1MHz	9			

Le TGF_100_AB_NS est disponible en 0.5 à 5mm d'épaisseurs.



Les résultats ont été obtenus en conditions de laboratoire et doivent être considérés uniquement à titre indicatif. ABZE n'ayant aucun contrôle sur le matériel de ses clients et sur de nombreux autres facteurs, il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer ses propres tests pour s'assurer que le produit correspond bien à ses besoins.

Nos Mousse Thermique appelés aussi Gap Pad ou Gap Filler sont des matériaux thermo conducteurs à base de silicone qui permettent de résoudre les problématiques de dissipation thermique. Le TEL_150_R est un matelas spécialement développé pour des applications où un besoin de refroidissement faible est demandé. En effet, celui-ci est un excellent conducteur thermique de 15W/mK, avec une bonne résistance thermique facilitant ainsi le transfert de la chaleur et qui ne possède pas d'isolation électrique. Nous pouvons découper selon plan client. Tous nos matelas sont certifiés UL 94 en V0.

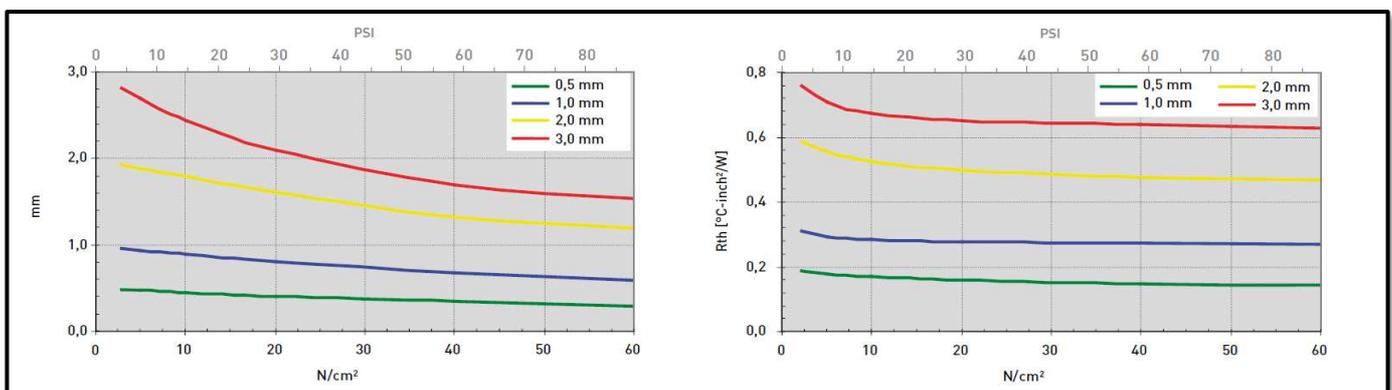


Domaines d'applications: Electronic components - Electric Vehicles, 5G, Autopilot System, Mobile Phone, AIOT, HPC (High Performance Computing), Server, IC, CPU, MOS, LED ,Mother Board, Power Supply, Heat Sink, LCD-TV, Notebook, PC, Telecom Device, Wireless Hub, DDR II Module, etc.

Caractéristiques techniques

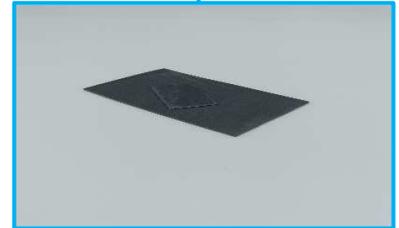
Caractéristiques	Unit	TEL_150_R			
Epaisseur	mm	0.5	1	2	-
Renforcement	-	-			
Couleur	-	Noir			
Dureté	Shore 00	55			
Taille	mm	150*150	150*150	140*140	-
Résistance @90 Psi	°C-inch ² /W (mm)	0.15 (0.30)	0.27 (0.60)	0.47 (1.20)	-
Résistance @30 Psi		0.16 (0.41)	0.28 (0.81)	0.50 (1.61)	-
Résistance @10Psi		0.18 (0.47)	0.29 (0.93)	0.54 (1.85)	-
Conductivité thermique	W/mK	15			
Température	°C	-50 to 180			
Tension de claquage	kV/mm	-			
Résistance volumique	Ohm - cm	$\geq 1 \times 10^{12}$			
Contante dielectric	@1MHz	-			

Le TEL_150_R est disponible en 0.5/1/1.5/2/3mm d'épaisseurs.



Les résultats ont été obtenus en conditions de laboratoire et doivent être considérés uniquement à titre indicatif. AB2E n'ayant aucun contrôle sur le matériel de ses clients et sur de nombreux autres facteurs, il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer ses propres tests pour s'assurer que le produit correspond bien à ses besoins.

Nos Mousse Thermique appelés aussi Gap Pad ou Gap Filler sont des matériaux thermo conducteurs à base de silicone qui permettent de résoudre les problèmes de dissipation thermique. Le TEL_160_YSS est un matelas spécialement développé pour des applications où un besoin de refroidissement faible est demandé. En effet, celui-ci est un excellent conducteur thermique de 16W/mK, avec une bonne résistance thermique facilitant ainsi le transfert de la chaleur et qui ne possède pas d'isolation électrique. Nous pouvons découper selon plan client. Tous nos matelas sont certifiés UL 94 en V0.

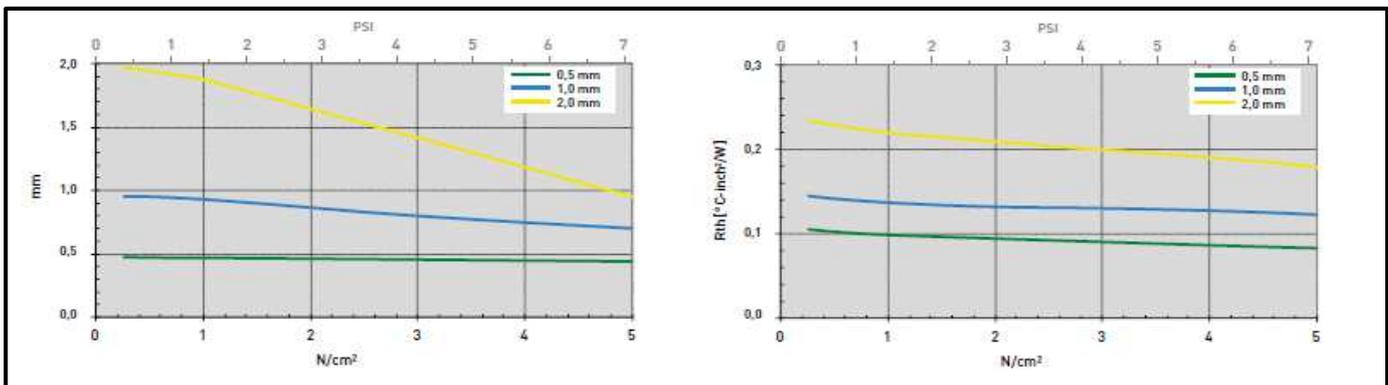


Domaines d'applications: Electronic components - Electric Vehicles, 5G, Autopilot System, Mobile Phone, AIOT, HPC (High Performance Computing), Server, IC, CPU, MOS, LED ,Mother Board, Power Supply, Heat Sink, LCD-TV, Notebook, PC, Telecom Device, Wireless Hub, DDR II Module, etc.

Caractéristiques techniques

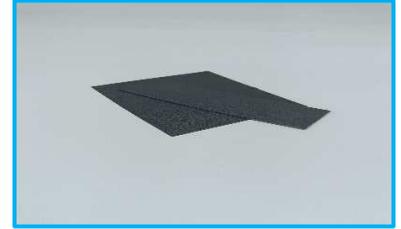
Caractéristiques	Unit	TEL_160_YSS			
		0.5	1	2	-
Epaisseur	mm	0.5	1	2	-
Renforcement	-	-			
Couleur	-	Noir			
Dureté	Shore 00	40			
Taille	mm	130*130			
Résistance @7.5 Psi	°C-inch ² /W (mm)	0.083 (0.42)	0.124 (0.700)	0.180 (0.954)	-
Résistance @3.5 Psi		0.089 (0.45)	0.129 (0.785)	0.205 (1.150)	-
Résistance @1.5Psi		0.100 (0.47)	0.137 (0.934)	0.220 (1.874)	-
Conductivité thermique	W/mK	16			
Température	°C	-50 to 180			
Tension de claquage	kV/mm	-			
Résistance volumique	Ohm - cm	< 50,000			
Contante dielectric	@1MHz	-			

Le TEL_160_YSS est disponible en 0.5/1/1.5/2/3mm d'épaisseurs.



Les résultats ont été obtenus en conditions de laboratoire et doivent être considérés uniquement à titre indicatif. AB2E n'ayant aucun contrôle sur le matériel de ses clients et sur de nombreux autres facteurs, il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer ses propres tests pour s'assurer que le produit correspond bien à ses besoins.

Nos Mousse Thermique appelés aussi Gap Pad ou Gap Filler sont des matériaux thermo conducteurs à base de silicone qui permettent de résoudre les problématiques de dissipation thermique. Le TEL_500_Z est un matelas spécialement développé pour des applications où un besoin de refroidissement faible est demandé. En effet, celui-ci est un excellent conducteur thermique de 50W/mK, avec une bonne résistance thermique facilitant ainsi le transfert de la chaleur et qui ne possède pas d'isolation électrique. Nous pouvons découper selon plan client. Tous nos matelas sont certifiés UL 94 en V0.

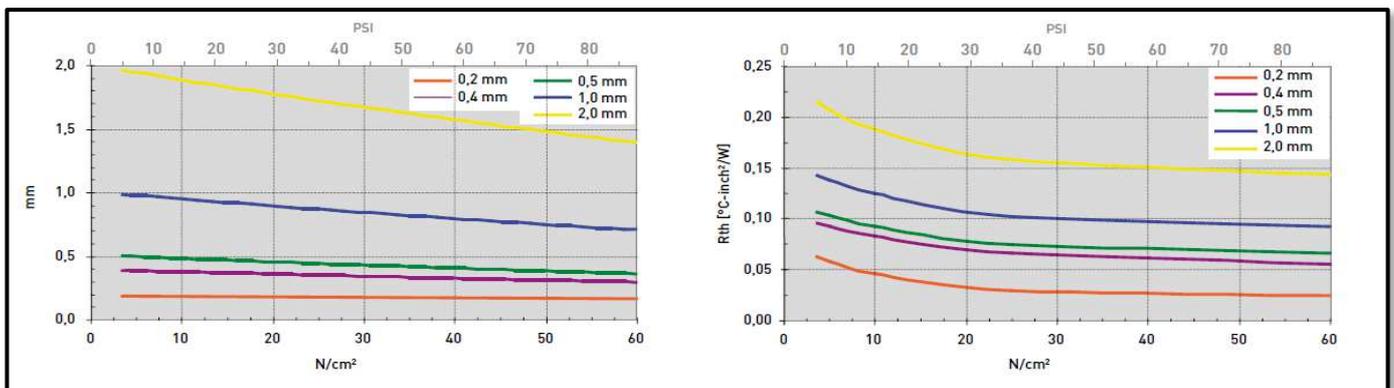


Domaines d'applications: Electronic components - Electric Vehicles, 5G, Autopilot System, Mobile Phone, AIOT, HPC (High Performance Computing), Server, IC, CPU, MOS, LED ,Mother Board, Power Supply, Heat Sink, LCD-TV, Notebook, PC, Telecom Device, Wireless Hub, DDR II Module, etc.

Caractéristiques techniques

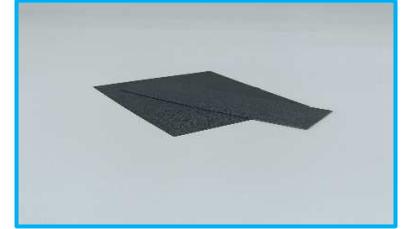
Caractéristiques	Unit	TEL_500_Z			
		0.2	0.5	1	-
Epaisseur	mm	0.2	0.5	1	-
Renforcement	-	-			
Couleur	-	Noir			
Dureté	Shore 00	75			
Taille	mm	140*140			
Résistance @90 Psi	°C-inch ² /W (mm)	0.020 (0.16)	0.060 (0.33)	0.09 (0.70)	-
Résistance @30 Psi		0.027 (0.18)	0.075 (0.48)	0.11 (0.91)	-
Résistance @10Psi		0.050 (0.19)	0.095 (0.49)	0.13 (0.97)	-
Conductivité thermique	W/mK	50			
Température	°C	-50 to 180			
Tension de claquage	kV/mm	-			
Résistance volumique	Ohm - cm	< 50,000			
Contante dielectric	@1MHz	-			

Le TEL_500_Z est disponible en 0.2/0.4/0.5/1/1.5/2mm d'épaisseurs.



Les résultats ont été obtenus en conditions de laboratoire et doivent être considérés uniquement à titre indicatif. AB2E n'ayant aucun contrôle sur le matériel de ses clients et sur de nombreux autres facteurs, il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer ses propres tests pour s'assurer que le produit correspond bien à ses besoins.

Nos Mousse Thermique appelés aussi Gap Pad ou Gap Filler sont des matériaux thermo conducteurs à base de silicone qui permettent de résoudre les problèmes de dissipation thermique. Le TEL_200_ZS est un matelas spécialement développé pour des applications où un besoin de refroidissement faible est demandé. En effet, celui-ci est un excellent conducteur thermique de 20W/mK, avec une bonne résistance thermique facilitant ainsi le transfert de la chaleur et qui ne possède pas d'isolation électrique. Nous pouvons découper selon plan client. Tous nos matelas sont certifiés UL 94 en V0.

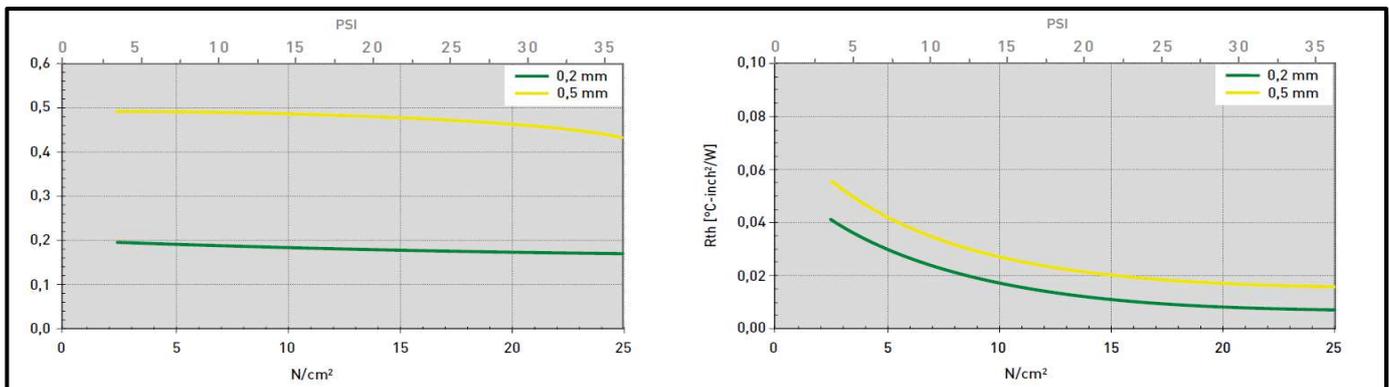


Domaines d'applications: Electronic components - Electric Vehicles, 5G, Autopilot System, Mobile Phone, AIOT, HPC (High Performance Computing), Server, IC, CPU, MOS, LED, Mother Board, Power Supply, Heat Sink, LCD-TV, Notebook, PC, Telecom Device, Wireless Hub, DDR II Module, etc.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Unit	TEL_200_ZS		
		0.2	0.3	-
Epaisseur	mm	0.2	0.3	-
Renforcement	-	-		
Couleur	-	Noir		
Dureté	Shore 00	60		
Taille	mm	120*120		
Résistance @90 Psi	°C-inch ² /W (mm)	0.007 (0.17)	0.018 (0.44)	-
Résistance @30 Psi		0.017 (0.18)	0.027 (0.44)	-
Résistance @10Psi		0.030 (0.19)	0.042 (0.49)	-
Conductivité thermique	W/mK	20		
Température	°C	-40 to 150		
Tension de claquage	kV/mm	-		
Résistance volumique	Ohm - cm	< 50,000		
Contante dielectric	@1MHz	-		

Le TEL_200_ZS est disponible en 0.2/0.3/0.5mm d'épaisseurs.



Les résultats ont été obtenus en conditions de laboratoire et doivent être considérés uniquement à titre indicatif. AB2E n'ayant aucun contrôle sur le matériel de ses clients et sur de nombreux autres facteurs, il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer ses propres tests pour s'assurer que le produit correspond bien à ses besoins.